

国信证券股份有限公司文件

国信〔2010〕174号

国信证券股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行保荐书

保荐机构声明：本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

一、本次证券发行基本情况

（一）保荐代表人情况

李天宇 先生：

国信证券投资银行事业部业务部高级经理，管理学硕士，保荐代表人。2004 年进入国信证券从事投资银行工作，2006 年参与完成重庆钢铁境内首发项目，2009 年参与完成海陆重工非公开发行项目。

徐峰 先生：

国信证券投资银行事业部业务部副总经理，工商管理硕士，保荐代表人。1998-2002 年分别任职于华安证券有限责任公司深圳总部、资产管理总部和深圳投资银行部，2002-2005 年分别任职于北方证券有限责任公司投资银行总部和国际业务部，2005 年 2 月进入国信证券从事投资银行工作，主持完成了中航光电首发项目，兴民钢圈首发项目。

（二）项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人

蒋猛 先生

国信证券投资银行部项目经理，中国注册会计师；2004-2008 年任职于大信会计师事务所有限公司，2008 年 3 月进入国信证券从事投资银行业务。

2、其他项目组成员

李震 先生：

国信证券投资银行事业部业务部副总经理，经济学硕士，保荐代表人。1998 年开始从事投资银行工作，先后负责或参与

了江西水泥 1999 年度配股、洪都航空首发、动力源首发、巨轮股份首发、重庆钢铁首发、华联综超 2006 年定向增发、三全食品首发、阳光发展重大资产重组等项目；并作为签字保荐代表人完成了御银股份 2009 年定向增发项目。

周浩 先生：

国信证券投资银行事业部业务部项目经理，管理学硕士。
2008 年加入国信证券从事投资银行业务。

胡滨 先生：

国信证券投资银行事业部业务部项目经理，管理学硕士。
2008 年加入国信证券从事投资银行业务。

徐学文 先生：

国信证券投资银行事业部业务部项目经理，管理学硕士。
2008 年加入国信证券从事投资银行业务。

(三) 发行人基本情况

公司名称：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“发行人”）

注册地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3 区 3 号厂

成立时间：2001 年 7 月 17 日（公司成立）

2008 年 5 月 13 日（整体变更）

联系电话：0755-27343066

经营范围：生产、销售、开发连接器件、精密五金件、精密接插件（以上不含国家限制项目）。自营进出口业务（按深贸

管登证字第 2004-0433 号文经营)。

本次证券发行种类：人民币普通股（A 股）

（四）发行人与保荐机构的关联情况说明

1、截至本次发行前，除本保荐机构（主承销商）国信证券全资子公司国信弘盛投资有限公司（以下简称“国信弘盛”）持有发行人 6.9767%的股权外，本保荐机构或控股股东、实际控制人、其他重要关联方均未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职的情况；

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

5、本保荐机构与发行人之间无其他关联关系。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 63 号）第四十三条的规定“保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过 7%，或者发行人持有、控制保荐机构的股份超过 7%的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应联合 1 家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构。”

截至本次发行前，国信弘盛合计持有发行人的股份未超过7%，因此无需进行联合保荐。本保荐机构业已经严格按照相关法律法规的要求，制定了完善的内部控制、风险控制、信息隔离等制度，各部门业务独立运行。上述关联关系不会对本保荐机构及保荐代表人公正履行保荐职责产生影响。

（五）保荐机构内部审核程序和内核意见

1、国信证券内部审核程序

国信证券内核小组依据国信证券内核工作程序对深圳市长盈精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件实施了内核，主要工作程序包括：

（1）深圳市长盈精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目申请文件由保荐代表人发表明确推荐意见后报项目组所在部门进行内部核查。部门负责人组织对项目进行评议，并提出修改意见；2010年1月22日，项目组修改完善申报文件完毕、并经部门负责人同意后提交公司投资银行事业部内核办公室进行审核。

（2）投资银行事业部审核人员、风险监管总部审核人员分别对申报材料进行审核，对项目进行现场考察并提出审核反馈意见；行业分析员对项目进行现场考察后出具独立分析意见。项目人员对投资银行事业部、风险监管总部提出的审核反馈意见进行答复、解释、修改，项目人员的反馈经认可后，内核办公室将申报材料、内核会议材料提交内核小组审核，并送达内

核小组会议通知。

（3）证券发行内核小组以内核小组会议形式工作，每次会议由 7 名内核小组成员参加并表决。与会内核小组成员就本申请文件的完整性、合规性进行了审核，查阅了有关问题的说明及证明资料，听取项目组的解释，并形成初步意见。

（4）内核小组会议形成的初步意见，经内核办公室整理后交项目组进行答复、解释及修订。申请文件修订完毕并由风险监管总部复核后，随内核小组结论意见提请公司投资银行委员会进行评审。

2、国信证券内部审核意见

2010 年 2 月 6 日，国信证券召开内核小组会议审议了深圳市长盈精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。

内核小组经表决，同意在项目组落实内核小组意见后提交国信证券投资银行委员会表决，通过后向中国证监会推荐。

二、保荐机构承诺

（一）本保荐机构承诺已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

（二）本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，承诺如下：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照本办法采取的监管措施。

三、对本次证券发行的推荐意见

（一）推荐结论

本保荐机构经充分尽职调查、审慎核查，认为深圳市长盈精密技术股份有限公司本次公开发行股票并在创业板上市履行了法律规定的决策程序，符合《公司法》、《证券法》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（以下简称“《暂

行办法》”）等相关法律、法规、政策、通知中规定的条件，募集资金投向符合国家产业政策要求，本保荐机构同意向中国证监会保荐深圳市长盈精密技术股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市。

（二）本次发行履行了法定的决策程序

本次发行经长盈精密第一届董事会第十次会议和二〇一〇年第一次临时股东大会审议通过，符合《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序。

（三）本次发行符合《证券法》第十三条规定的发行条件

- 1、发行人具备健全且运行良好的组织机构；
- 2、发行人具有持续盈利能力，财务状况良好；
- 3、发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
- 4、发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

（四）本次发行符合《暂行办法》规定的发行条件

- 1、经本保荐机构查证确认，发行人首次公开发行股票并在创业板上市符合《暂行办法》第十条以及相关规则的规定：

（1）经本保荐机构查证确认，发行人前身为深圳市长盈精密技术有限公司（以下简称“长盈有限”），其股东于2008年4月18日签订《发起人协议》，并于2008年4月18日召开创立大会，整体变更为股份有限公司。发行人取得原深圳市工商行

政管理局颁发的注册号为 440306102981504 的《企业法人执照》。发行人依法设立，不存在根据法律、法规以及发行人章程需要终止的情形，系有效存续的股份有限公司。

经本保荐机构查证确认，发行人系从有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更成立之股份有限公司，持续经营时间从有限责任公司成立之日起计算，已在 3 年以上，符合《暂行办法》第十条第（一）项的规定。

（2）根据天健会计师事务所有限公司（以下简称“天健”）出具的《审计报告》（天健审（2010）3-26 号），发行人最近两个会计年度净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 4,360.53 万元、5,253.33 万元，均为正数且持续增长；两个会计年度净利润累计为 9,613.86 万元，超过人民币一千万元，符合《暂行办法》第十条第（二）项的规定。

（3）根据天健出具的《审计报告》（天健审（2010）3-26 号），发行人最近一期末净资产 27,089.69 万元，且不存在未弥补亏损，符合《暂行办法》第十条第（三）项的规定。

（4）发行后股本总额将为八千六百万元，不少人民币三千万元，符合《暂行办法》第十条第（四）项的规定。

2、经本保荐机构查证确认，除整体变更外，发行人股东的历次出资均为货币出资，根据开元信德会计师事务所于 2008 年 4 月 18 日出具的开元信德深验资字（2008）第 012 号《验资报告》以及本保荐机构核查，发行人的注册资本已足额缴纳，发

起人用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《暂行办法》第十一条的规定。

3、发行人作为国内领先的专业从事电子信息产业精密电子零组件的开发、设计、生产和销售先进制造企业，其生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政策。经本保荐机构查证确认，符合《暂行办法》第十二条的规定。

4、经本保荐机构查证确认，经核查，发行人最近两年内主营业务为专业从事电子信息产业精密电子零组件的开发、设计、生产和销售，近两年未发生重大变化；发行人的董事和高级管理人员近两年未发生重大变化；发行人的实际控制人为陈奇星先生，近两年未发生变更。符合《暂行办法》第十三条的规定。

5、根据发行人承诺，并经本保荐机构查证确认，发行人具有持续盈利能力，不存在下列情形，符合《暂行办法》第十四条的规定：

（1）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（2）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(3) 发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险;

(4) 发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖;

2007-2009 年发行人向深圳华为和深圳中兴合计销售占比分别为 56.44%、59.33%和 49.21%，呈下降趋势。深圳华为和深圳中兴是行业内知名企业，与发行人无关联关系。发行人最近一年的营业收入或净利润不存在对关联方或者有重大不确定性客户存在重大依赖，符合《管理办法》第十四条第四款的规定。

(5) 发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益;

(6) 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

自 2003 年以来，发行人租用的生产经营场所保持稳定，租赁厂房对发行人正常生产经营不存在重大影响；并且发行人能够有效解决生产经营场所搬迁可能面临的风险。符合《管理办法》第十四条第六款的规定。

6、发行人及各子公司依照法律法规及当地主管税务机关的要求纳税，当地主管税务机关均出具了合法纳税证明文件。发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，经本保荐机构查证确认，符合《暂行办法》第十五条的规定。

7、经本保荐机构查证确认，发行人不存在重大偿债风险，

不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《暂行办法》第十六条的规定。

8、经本保荐机构查证确认，发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份不存在重大权属纠纷，符合《暂行办法》第十七条的规定。

报告期内，发行人为了保持公司经营管理团队稳定性，提高员工的主人翁意识，增强公司员工凝聚力，对公司高管等实施了股权激励；为了公司发展战略的需要而引入了股权投资机构，股权转让真实、合法、有效。发行人不存在委托持股、信托持股等情形，不存在其他身份不适合投资的人士持有发行人股份的情形，符合《管理办法》第十七条的规定。

9、经本保荐机构查证确认，发行人符合《暂行办法》第十八条的规定：

（1）经本保荐机构查证确认，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（2）经本保荐机构查证确认，发行人的资产完整并独立于股东单位及其他关联方。公司系整体变更设立，各股东出资全部及时到位，出资情况业经开元信德会计师事务所出具的开元信德深验资字（2008）第 012 号《验资报告》验证。公司独立拥有生产经营必要的资产，且产权清晰。公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资源的情形。

（3）经本保荐机构查证确认，发行人的人员独立。发行人

董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及发行人《公司章程》合法产生；发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；发行人财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职，未在与发行人业务相同或相近的其他企业任职。

（4）经本保荐机构查证确认，发行人设立有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；发行人在银行独立开立账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（5）经本保荐机构查证确认，发行人的机构独立。发行人建立健全了股东大会、董事会、监事会、审计委员会、薪酬与考核委员会及总经理负责的管理层等机构及相应的议事规则，形成了完善的法人治理结构。发行人建立了适应生产经营需要的组织结构，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系及其配套部门。发行人与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况；发行人各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预发行人正常生产经营活动的现象。

（6）经本保荐机构查证确认，发行人的业务独立。公司由

长盈有限整体变更设立，在变更设立之前，长盈有限即已具有独立的采购、生产、销售体系及相关部门，因而公司自成立之日就具有独立自主进行生产经营活动的能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动，与实际控制人及其控制的其他企业、公司其他股东所从事业务完全独立。

发行人控股股东长盈投资、实际控制人陈奇星已向发行人出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事构成与发行人业务存在同业竞争的经营活动。

（7）经本保荐机构查证确认，发行人在独立性方面不存在其他严重缺陷。

10、经本保荐机构查证确认，发行人具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度、薪酬与考核委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《暂行办法》第十九条的规定。

11、经本保荐机构查证确认，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，

符合《暂行办法》第二十条的规定。

12、经本保荐机构查证确认，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《暂行办法》第二十一条的规定。

13、经本保荐机构查证确认，发行人具有严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《暂行办法》第二十二条的规定。

14、经本保荐机构查证确认，发行人的公司章程已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《暂行办法》第二十三条的规定。

15、经本保荐机构查证确认，发行人的董事、监事和高级管理人员已经经过本保荐机构组织的相关辅导，并于2010年1月通过了辅导考试，了解了与股票发行上市有关的法律法规，知悉了上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《暂行办法》第二十四条的规定。

16、根据发行人及其董事、监事、高级管理人员承诺，并经本保荐机构核查，发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不存在下列情形，

符合《暂行办法》第二十五条的规定：

（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易所公开谴责的；

（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。

17、经本保荐机构查证确认，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为，符合《暂行办法》第二十六条第一款的规定；

经本保荐机构查证确认，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行政券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形，符合《暂行办法》第二十六条第二款的规定。

18、根据发行人二〇一〇年第一次临时股东大会决议，发行人本次拟募集资金拟用于生产表面贴装式 LED 精密封装支架项目、生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目和生产手机及数码产品滑轨项目等三个项目。经本保荐机构查证确认，发行人本次募集资金均投资于发行人的主营业务，有明确的用途。根据发行人提供的《可行性研究报告》，以及昆山市发展与改革委员会出具的备案确认（项目备案文号分别为昆发改投备（2009）字第 129 号、昆发改投备（2009）字 130 号、昆发改

投备（2009）字 131 号），本保荐机构查证确认，发行人募集资金数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

19、经本保荐机构查证确认，发行人已经建立募集资金专项存储制度，募集资金专项存储制度规定募集资金存放于董事会决定的专项帐户，符合《暂行办法》第二十八条的规定。

综上所述，本保荐机构认为，发行人符合《公司法》、《证券法》、《暂行办法》规定的首次公开发行股票并在创业板上市的实质条件。

（五）发行人面临的主要风险

1、客户集中度较高的风险

公司围绕大客户开发的市场战略，积极开拓和经营国内外知名品牌客户，积累了一大批包括三星、华为、中兴通讯、宇龙酷派、联想、海尔、比亚迪电子等核心优质客户，并与其建立了良好的合作关系，形成了相对稳定的客户群。2007 年、2008 年、2009 年公司向前五名客户销售总额分别为 13,089.02 万元、16,924.78 万元、15,803.58 万元，占公司当期营业收入的 72.11%、69.47%、57.25%。随着公司客户群体的逐渐扩大，产品应用领域扩展，公司客户集中度呈下降趋势。但如果主要客户生产经营状况发生不利的变化，将会引起公司当期收入和利润的波动。

公司对华为、中兴两名客户销售额占公司营业收入比例较

高，2007～2009 年，公司对华为的销售额为 5,858.45 万元、7,965.21 万元、7,298.77 万元，占同期营业收入的 32.28%、32.70%和 26.44%；公司对中兴的销售额为 4,385.65 万元、5,311.66 万元、5,395.98 万元，占同期营业收入的 24.16%、21.80%和 19.55%。公司与上述两名客户合作均达到五年以上，供应的产品品种和数量逐年增加。公司依靠竞争优势已成为华为、中兴两家公司的战略合作伙伴，公司的产品开发能力、产品制造能力、公司的服务能力和公司规模，已得到上述两家公司的高度认可，未来华为、中兴仍将是公司的重要客户。如果华为、中兴生产经营发生重大不利变化，将影响到本公司生产经营，给公司经营业绩造成不利影响。

2、生产厂房租赁风险

目前，本公司生产厂房中有四处为租赁取得，位于深圳市宝安区福永街道桥头富桥工业 3 区，截至本招股说明书签署之日，公司租赁场所面积为 22,892 平方米，占公司整体经营面积的 62.17%。租赁合同约定的租赁期分别至 2010 年 12 月 31 日和 2012 年 10 月 30 日，到期后公司有优先续租权。上述厂房租赁合同已经深圳市宝安区房屋租赁管理办公室备案登记，合同备案号分别为宝 CA031015（备）号、宝 CA031016（备）号、宝 CA031493（备）号、宝 CA031497（备）号。出租方深圳市桥头股份合作公司系村办实体，因历史原因未取得出租房屋的产权证书，若租赁的厂房在租赁的有效期内被强制拆迁或因其他原

因无法继续出租，公司存在部分经营场所搬迁的风险。本公司是制造服务型企业，产品生产主要依靠产品前端设计和单件小型精密加工设备，生产线的安装程序较为简单，易于搬迁。深圳市工业厂房的租赁市场交易活跃，公司可以在较短时间内找到符合条件的替代厂房，租赁厂房的被迫搬迁不会对公司持续经营产生重大影响。

深圳市规划和国土资源管理委员会宝安管理局已出具证明，本公司租赁的厂房所涉土地为深圳市桥头股份合作公司建设用地，上述厂房目前未纳入城市更新改造拆迁范围，也未列入政府拆迁规划。出租方深圳市桥头股份合作公司承诺，至 2012 年 1 月末前，没有改变其用途或者拆除计划，如因租赁厂房拆迁或其他原因致使出租方无法履行租赁合同，将提前通知本公司，并给予合理搬迁时间。公司控股股东长盈投资、实际控制人陈奇星先生出具承诺：“如果发行人因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，并给发行人造成经济损失（包括但不限于拆除、处罚的直接损失，或因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），陈奇星将与长盈投资就发行人实际遭受的经济损失，向发行人承担连带赔偿责任，以使发行人不因此遭受经济损失。”

报告期内，公司的租赁费用支出分别为 103.80 万元、175.50

万元、223.70 万元，占公司营业费用（营业成本及三项费用之和）的 0.75% 0.92%1.05%，租赁支出占公司营业费用的比例较低，对公司盈利能力不构成重大影响。为确保公司生产经营稳定及业务进一步发展的需要，公司全资子公司昆山长盈已于 2008 年 4 月在昆山市取得 33,215.90 平方米的国有土地使用权，已建设完成 13,932.15 平方米的厂房，用于生产规模的扩大和产业战略布局。公司正在争取在深圳或深圳周边购置自有土地并建造厂房，以求从根本上解决租赁经营场地对公司经营造成的可能影响。

3、募集资金投资项目的风险

本次募集资金主要投资于“生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”、“生产表面贴装式 LED 精密封装支架项目”、“生产手机及数码产品滑轨项目”三个投资项目，上述三个项目投资总额为 36,679.85 万元。项目达产后，根据项目可行性研究报告，预计年新增销售收入 57,579.50 万元。在本次募集资金投资项目提出之前，公司对精密电子零组件市场进行了充分的调研，对此次投资项目经过了慎重的可行性研究论证，并对公司的市场份额、竞争优势、营销和服务能力等进行了深入分析。公司认为新增产能的规模与市场容量和公司未来五年内的发展战略目标相适应，但不排除由于市场环境的变化，使募集资金投资项目的实际效益与可行性研究存在一定的差异。

4、重要原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括铜带、不锈钢带和工程塑料等，上述原材料成本合计占公司产品材料成本的 70%左右。2007 年以来，铜、钢材等金属材料价格波动较大，加大了公司经营管理的难度。

公司一方面与客户协商确定产品价格时，充分考虑主要原材料价格波动对产品成本的影响；另一方面，在保证合理库存的前提下，根据原材料市场价格变动趋势，灵活主动地进行原材料采购，以降低原材料平均成本。但如果主要原材料价格出现大幅波动，仍将对公司的经营业绩带来一定的影响。

5、不能持续快速响应市场需求的风险

公司产品以定制化生产为主，客户需求的个性化较为明显。公司依托强大的研发、设计、制造能力，在深刻理解客户需求的基础上快速设计解决方案，及时匹配采购相关原材料，高效组织生产，形成快速响应，为客户产品迅速推向市场提供有力的支持。

报告期内，公司每年新产品开发数量保持 50%以上增长，模具开发数量由 2007 年的 550 副/年增加到 2009 年的 1,830 副/年。目前，公司能根据客户需求在 2 天内完成模具设计，8 天内完成模具制作，最快 10 天内投入量产。公司从模具设计到批量生产的整个生产周期通常为 20 天，远高于行业 30-40 天的平均水平，处于行业领先地位。

随着业务规模扩大、产品品种增加、应用领域拓广，面对

众多客户日益多样化的需求，公司一方面扩充研发团队，增加产品研发和模具设计能力；一方面加大设备投入，扩大产能。但公司仍存在因快速设计能力和高效组织生产能力不足，而不能持续快速响应客户需求的风险。

6、净资产收益率下降的风险

2007 年、2008 年和 2009 年，本公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）分别为 79.22%、28.45%和 26.13%，年末净资产分别为 13,046.37 万元、17,616.46 万元和 27,089.69 万元。本次发行后，公司净资产将大幅增长。由于募集资金项目从投入到产生效益需要一定的时间，且募集资金投资项目投产初期对公司的业绩增长贡献相对较小。因此，短期内公司净利润的增长幅度将小于净资产的增长幅度，公司存在净资产收益率下降的风险。

7、折旧及摊销额增加影响公司盈利能力的风险

截至 2009 年 12 月 31 日，公司拥有的固定资产净值 7,167.19 万元，占总资产的比重为 18.41%，公司的固定资产规模相对较小。根据募集资金使用计划，本公司募集资金投资项目中的固定资产投资总计为 24,006.09 万元，占项目投资总额的比例为 65.45%。本次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产规模将大幅增长。募投项目达产后，根据可行性研究报告，预计每年新增销售收入约为 57,579.50 万元，每年新增固定资产折旧、无形资产摊销等增量费用占新增销售收入的 3%，占新

增营业利润的 11%，所占比重均较低，公司具备足够的安全边际消化新增折旧费用及无形资产摊销给公司盈利带来的影响。随着募集资金项目投产后效益的逐步发挥，新增固定资产折旧、无形资产摊销对公司经营成果的影响也将逐步减小。但是如果未来市场环境或市场需求出现重大变化造成募集资金投资项目不能产生预期收益，新增固定资产折旧及无形资产摊销带来的费用增长将对公司未来业绩造成一定压力。

8、应收账款发生坏帐的风险

截至 2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和 2009 年 12 月 31 日，本公司应收账款余额(扣除坏账准备)分别为 6,135.10 万元、5,228.05 万元和 6,884.46 万元，占同期资产总额的比例分别为 27.94%、21.15%和 17.68%，应收账款的按期收回对公司财务状况构成影响。公司的主要客户均为信誉良好的国内外知名企业，能够按约定及时支付公司的销售货款，有效保证了公司应收账款的资产质量。截至 2009 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄在 1 年以内的比例为 94.40%，公司已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备，应收账款发生呆坏账的可能性较小。但如果本公司在短期内出现应收账款大幅上升，或主要债务人的财务经营状况发生恶化，则可能存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足的风险。

9、税收优惠政策变化的风险

根据《深圳市人民政府关于深圳经济特区企业税收优惠若

干问题的规定》（深府[1988]232号）的规定，深圳市地方税务局第三检查分局于2003年7月10日以深地税三函[2003]349号文批准同意本公司从获利年度（即2003年）起享受“两免三减”的所得税优惠政策，因此，本公司从2003年至2004年免征所得税，从2005年至2007年按15%的税率按应税所得额减半计缴企业所得税。减半缴纳企业所得税是深圳市的税收优惠政策，存在被国家主管税务机关要求补缴的风险。

就上述补缴税款风险事宜，公司控股股东长盈投资、实际控制人陈奇星先生已出具承诺：“若发行人首次公开发行（A股）股票并在创业板上市前各年度所享受的税收优惠被有关政府部门追缴，则长盈投资及陈奇星将以连带责任方式，无条件全额承担发行人在上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。”

2008年12月，公司被认定为国家级高新技术企业，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR200944200106），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自2008年（含2008年）起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。公司执行的高新技术企业优惠政策在有效期内具有连续性及稳定性，如国家调整税收政策，或有效期满后公司不能继续被认定为高新技术企业，公司存在税收优惠政策变化所导致的风险。

10、技术风险

本公司作为国家级高新技术企业，高度重视技术研发工作，以此推动公司的新技术开发和产业化，确保公司的营业收入及盈利水平的增长。公司一直致力于精密电子零组件的开发、生产和销售，根据市场需求开发了精密型电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式 LED 精密支架等一系列产品，产品技术水平和工艺质量均处于行业领先水平，为公司赢得了良好的市场声誉。2007 年、2008 年和 2009 年公司研发费用占主营业务收入的比重分别为 4.08%、8.88%和 8.80%。但由于技术及产品的快速更新换代可能对公司应用现有技术的产品生产构成冲击，如公司不能紧跟最新科技的发展，及时利用新技术，开发新产品，现有的产品和技术存在被淘汰的风险；或由于研发过程中的不确定因素而导致的技术开发失败或新技术无法产业化，将延缓公司营业收入及盈利能力的增长步伐，给公司经营带来风险。

11、公司规模扩大引致的管理风险

本公司自成立以来持续快速发展，2007 年、2008 年和 2009 年营业收入分别为 18,151.47 万元、24,361.01 万元和 27,603.19 万元；归属于母公司所有者的净利润分别为 3,805.79 万元、4,575.02 万元和 5,423.23 万元；员工人数也从 2007 年初的 662 人迅速扩充到 2009 年 12 月底的 2,022 人。本次发行后，随着募集资金投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员将进一步扩张。

尽管公司管理层在多年的经营过程中积累了丰富的管理经验，建立了规范的法人治理体系、质量控制及项目管理体系，经营模式和营销体系也较为成熟，但仍然存在现有管理体系不能适应未来公司快速扩张的风险。如果公司管理体系不能适应发展的需要，公司的经营业绩将受到一定程度的影响。

12、内部控制有效性不足导致的风险

本公司已经建立健全了较为完整、合理和有效的内部控制制度，包括风险识别及评估、资产管理、交易授权、关联交易决策、财务管理、内部审计、人力资源管理及质量管理等方面的制度。内部控制制度有效运行，保证了公司经营管理活动正常有序地开展，有效控制了风险，确保了公司经营管理目标的实现。但是，若这一内控体系不能随着公司的发展而不断完善，存在公司出现内部控制有效性不足的风险。

（六）发行人的发展前景

1、发行人所处行业具有良好发展前景

（1）产业政策的支持

《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划（纲要）》（原国家信息产业部发布2006年5月）、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会2000年8月）、《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发展和改革委员会2005年12月）、《电子信

息产业调整和振兴规划》(2009 年 4 月)、《半导体照明节能产业发展意见》(国家发改委、科技部、工信部、财政部、住房和城乡建设部、国家质量监督检验检疫总局 2009 年 10 月)等多项法律法规将精密电子零组件产业作为国家优先发展的重点产业。

(2) 广阔的市场前景

发行人所处精密电子零组件行业作为我国电子信息业重要发展的产业，未来仍将保持高速的发展，经营环境仍将持续改善；发行人具有独特的竞争优势，在行业内的地位不断提升；本次募集资金拟投资项目论证充分，项目符合国家产业政策，项目实施后，发行人将进一步提升在行业内的竞争地位和品牌影响力。综上，本保荐机构认为发行人的未来发展前景良好。

2、发行人具备多方面的竞争优势

(1) 产品设计优势

截至 2009 年末，发行人拥有研发人员 110 名，其中产品设计师 91 人。产品设计团队对电子信息行业的市场变化趋势、技术进步、发行人生产能力及下游客户需求有深刻的理解和把握，设计师均具有丰富的电子零组件产品设计经验，能娴熟地应用 pro/E、CAD 和模流分析等电脑辅助工具软件高效工作。2009 年，发行人共设计精密型电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨、表面贴装式 LED 精密支架等新产品达到 1,092 款。发行人凭借业内领先的产品设计开发技术、精密模具设计开发技术，具备与

下游客户共同研究、确定设计方案，共同制定产品技术标准，并与下游客户同步设计的能力，提高了产品设计水平。发行人通过自主创新，设计了多种精密电子零组件新产品，其中复合式屏蔽件、表面贴装式 LED 精密支架、旋转式滑轨和大行程大推力手机滑轨等，均属于创新型设计，更是发挥出引领市场需求的作用。

（2）产品创新优势

发行人自成立以来，一直以产品创新作为企业发展的首要任务，成立了技术开发中心，近两年每年将销售收入的 8%左右用于新产品开发。在电磁屏蔽件产品创新方面，2004 年在中国本土企业中率先开发出用于移动通信终端和数码产品的精密型电磁屏蔽件；2008 年在中国本土企业中率先开发出用于移动通信终端和数码产品的复合式电磁屏蔽件。在连接器产品创新方面，2004 年开发出移动通信终端和数码产品精密连接器；2007 年打破国外企业垄断，开发出移动通信终端和数码产品用的微射频连接器；2007 年在中国本土企业中率先实现用于移动通信终端和数码产品连接器品种的系列化。2009 年在中国本土企业中率先开发出表面贴装式 LED 精密支架和旋转式滑轨，并开始进入批量化生产和销售。

围绕着上述产品的开发，发行人持之以恒地进行核心技术的研发，先后实现了多项技术的突破，包括：①通过对超精密模具零件加工技术的攻关，使模具加工精度由 $5\mu\text{m}$ 提升到 $2\mu\text{m}$ ，

达到国际先进水平；②打破国外材料选用模式，应用金属材料替代工程塑料，开发出大推力大行程超薄型弹簧模组；③开发出小间距多料带冲压技术；④通过计算机模流分析和注塑工艺革新，掌握了在 49mm×96mm 的面积上可一模射出两百只微型模内注塑技术。

截至 2009 年底，发行人共申请 31 项专利技术，2009 年 1 月，微小型精密手机连接器被评为“深圳市自主创新产品”；2009 年 5 月，通信及数码产品屏蔽件被评为“深圳市科技成果”。

近三年，发行人新产品开发量大幅度增长，2007 年、2008 年和 2009 年分别开发新产品 459 款、683 款和 1,092 款，年复合增长率达到 50%以上，其中手机和数据卡精密型电磁屏蔽件新产品开发量位居全球第一。因发行人在产品创新方面取得突出成绩，2008 年，发行人荣获“国家级高新技术企业”称号和“深圳市自主创新行业龙头企业”称号，2009 年，发行人荣获“深圳市 2009 年度自主创新百强中小企业”称号。

（3）精密模具开发优势

发行人是中国模具工业协会会员，是深圳市机械行业协会模具专业委员会理事单位。发行人精密模具开发实力强大，拥有一支 60 余人的专业模具设计师团队。小型精密五金高速连续冲压模具方面优势明显，2009 年开发该类模具 1,830 套，位居全球第三；在精密五金模具方面，发行人能够开发精度较高的多工位连续级进模、拉伸模、小间距多料带模，最高可达 1100

次/分，寿命可达 3 亿冲次以上，模具全部采用日本、德国的连续高速级进冲压模具结构制式，在国内处于领先地位；在塑胶模方面，以开发微小型精密塑模为主，能够开发立式注塑模、卧式注塑模、模内注塑模。立式注塑模、卧式注塑模一模可出 16 件或 32 件，具有国内领先水平，适合生产各种微小轻薄的产品。微型模内注塑模是为贴装式 LED 精密支架产品而专门攻关开发的，精密度更高，关键零件精度达 $\pm 1\mu\text{m}$ ，为国际先进水平，模具开发周期最短可达 8 天。

截至 2009 年末，发行人拥有 157 台套的进口模具加工设备，100 多台精密测量设备，从事模具零件加工、模具组立的技工技师达到 500 多人，具备月产精密级进模 180 套、精密塑胶模 50 套的制造能力，强大的精密模具开发能力为精密电子零组件的开发生产提供保证。

（4）精密制造技术优势

发行人拥有高端精密的生产设备、经验丰富的技术工人、成熟精湛的技术工艺、高效严格的现场管理等生产要素，拥有各类产品生产所需的精密模具开发、精密冲压、精密射出成型、激光焊接应用、产品测量、自动化生产装备设计开发、环保清洗应用、一体化攻牙、实验与测试等全工艺生产技术，确立了发行人在行业内的精密制造技术优势。发行人将精密模具开发制造优势与精密制造优势较好的结合起来，形成了强大的精密电子零组件产品整体制造优势。

（5）大客户优势

服务于大客户并与大客户共同成长，是发行人的重要发展战略，也是发行人的竞争优势所在。发行人始终瞄准国际国内一流品牌客户发展业务，现已成为三星、华为、中兴通讯、联想、海尔、海信、TCL-阿尔卡特、宇龙酷派、比亚迪、天语、国虹、金立和好易通等二十多家国内外知名大客户的紧密合作伙伴。上述核心客户的产品系列较为广泛，精密电子零组件需求量大，为发行人未来业绩增长提供了充分保障。

（6）响应速度优势

对于下游客户 80%左右的新产品开发和供货要求，发行人能在 2 天内完成模具设计，8 天内完成模具制作，最快 10 天内投入量产，从模具设计到批量生产周期通常为 20 天，远高于 30-40 天的行业平均水平。对于时间较紧的特殊订单，发行人建立了绿色通道制度，充分调动发行人的设计、生产资源，适应客户快速推出的新产品计划。发行人的响应速度优势，确保发行人能够紧跟下游客户的产品更新换代的步伐。

（7）成本优势

发行人采取全工艺、全制程、内部垂直整合的生产模式，发行人产品生产所涉及的前期研发、产品设计、模具零件加工、精密冲压、精密射出成型、自动化组装设备开发、自动化组装、包装材料、产品测试等生产制程均由发行人自主完成。这种垂直整合的生产模式不仅有利于控制发行人产品品质、保证产品

的按期交付，也确立了发行人的成本优势。

附件：

1、《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐代表人的专项授权书》

2、《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司成长性的专项意见》

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书》之签字盖章页】

项目协办人：

蒋 猛

蒋 猛

保荐代表人：

李天宇

李天宇

2010年7月9日

徐 峰

徐 峰

2010年7月9日

内核负责人：

龙 涌

龙 涌

2010年7月9日

保荐业务负责人：

胡华勇

胡华勇

2010年7月9日

法定代表人：

何 如

何 如

2010年7月9日



附件 1

国信证券股份有限公司
关于保荐深圳市长盈精密技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
保荐代表人的专项授权书

中国证券监督管理委员会：

国信证券股份有限公司作为深圳市长盈精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，特指定李天宇、徐峰担任本次保荐工作的保荐代表人，具体负责保荐工作、履行保荐职责。

法定代表人：


何 如



2010 年 7 月 9 日

国信证券股份有限公司
关于深圳市长盈精密技术股份有限公司
成长性的专项意见

中国证券监督管理委员会：

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“长盈精密”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的有关规定，已对发行人的成长性及自主创新能力进行充分尽职调查，确信发行人具备良好的成长性和自主创新能力。

一、发行人基本情况

发行人是由深圳市长盈精密技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，注册资本 6,450 万元。作为国内领先的精密电子零组件制造商，主要产品包括精密电磁屏蔽件类、精密连接器类、手机滑轨、表面贴装式 LED 精密支架等，产品广泛应用于移动通信终端、数码产品及光电产品等领域。

截至 2009 年底，发行人开发制造的用于手机和数据卡精密型电磁屏蔽件新产品开发量位居全球第一，市场份额中国本土企业第一。

发行人开发制造的用于移动通信终端的精密连接器产品，在中国本土企业中，产品品种最全，并成为国内品牌手机生产企业的主导供应商。

发行人开发制造的表面贴装式 LED 精密支架产品是中国本土企业中最早研发成功的，并最先实现规模化生产。

发行人是中国本土企业中最早开发成功大推力大行程手机滑轨弹簧模组的企业。发行人开发制造的正向滑动、侧向滑动、旋转滑动和曲面滑动等滑轨产品，达到国际先进水平。

发行人 2009 年开发小型精密五金高速连续冲压模具 1,830 套，开发量位居全球第三。

公司为中华全国工商业联合会直属会员企业，2008 年，公司被评为“国家级高新技术企业”、“深圳市自主创新行业龙头企业”、“深圳市工业 500 强企业”、“深圳市宝安区绿色环保示范企业”、“深圳市宝安区民营中小企业成长计划工程企业”；2009 年，公司被评为“深圳市自主创新百强中小企业”，公司的创新能力及发展潜力得到了政府机构的多方肯定。经过多年的发展，公司与三星、华为、中兴通讯、联想、海尔、海信、TCL-阿尔卡特、宇龙酷派、比亚迪、天语、国虹、金立和好易通等二十多家国际国内知名高端客户群体建立了战略合作伙伴关系，并多次获得客户授予的“合格供应商”、“优秀供应商”、“卓越供应商”、“商业合作伙伴”等荣誉称号，公司的创新能力及产品品质得到了客户的高度认可。

公司坚持以国际行业龙头为标杆，以持续创新为动力，以自主品牌经营为核心，致力于成为中国乃至全球移动通信终端、数码产品和光电产品精密电子零组件领域的领军企业。

二、精密电子零组件行业的现状及未来前景分析

（一）发行人所处精密电子零组件行业的现状

电子信息产业是我国工业的核心基础产业，改革开放以来，我国电子信息产业实现了持续快速发展，特别是进入 21 世纪以来，产业规模、产业结构、技术水平得到大幅提升。电子元器件行业是电子信息产业的重要组成部分，处于电子信息产业链的前端，在整个电子信息产业中是仅次于计算机的第二大细分行业。

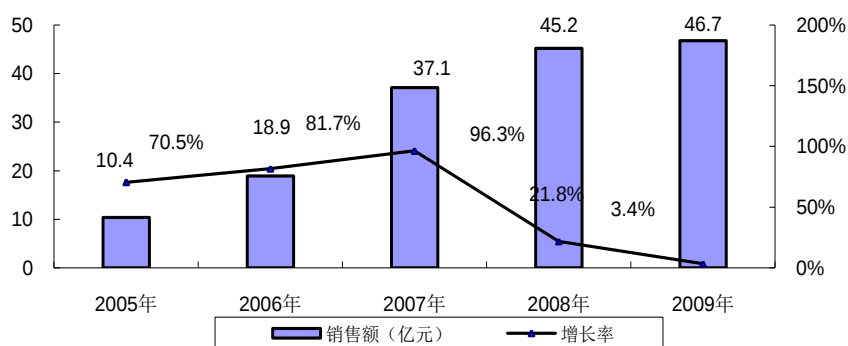
发行人所处的行业为精密电子零组件行业，属于电子信息行业中的电子元器件制造行业的高端，主营业务面向移动通信终端、数码产品和光电产品应用领域，主要产品为精密型电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨、表面贴片式 LED 精密支架等。

1、精密型电磁屏蔽件行业

无线产品的广泛使用，使电磁辐射对环境、人体健康以及电子产品正常工作造成的影响越来越大，不少国家对电子产品的电磁辐射值都有强制性的认证规定，因此精密型电磁屏蔽件已成为移动通信终端产品内部必要的零组件一，应用范围越来

越广泛。近年来，电子信息技术及生产工艺的发展，对电子产品的抗电磁辐射能力要求也越来越高，精密型电磁屏蔽件市场迎来高速增长，2005-2009年，全球精密型屏蔽产品年复合增长率达到39.6%，2009年精密型电磁屏蔽件全球市场销售规模达到80.6亿元，随着我国国民生活水平的提高和消费能力的增强，我国已经成为全球最大移动通信终端和消费电子市场，精密型电磁屏蔽产品在我国的销售规模超过全球市场的50%，2005-2009年，年复合增长率达到45.6%，2009年我国市场销售规模达到46.7亿元。

2005—2009年我国精密型电磁屏蔽件销售规模及增长



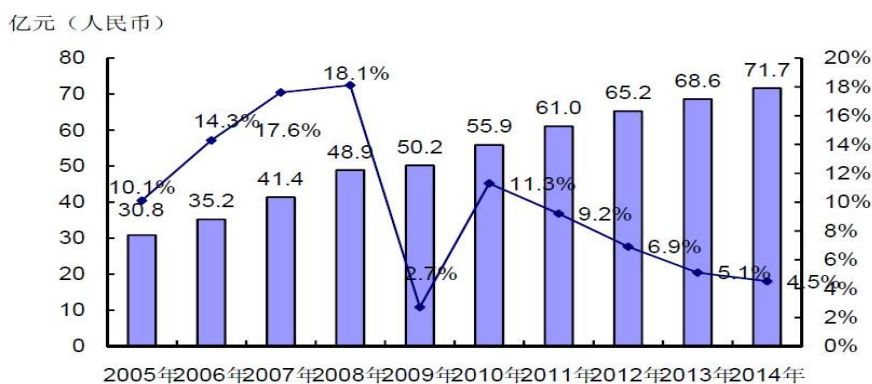
数据来源：赛迪顾问《2009-2010 年中国电子产品五金零部件市场研究报告》

2、精密连接器

2005年以来，随着全球移动通信终端和数码产品市场的增长，全球精密连接器市场也呈现快速上升趋势。移动通信终端和消费电子产业的繁荣已经成为连接器需求增长的主要驱动力。

我国是全球连接器增长最快的市场，我国移动通信终端和数码产品精密连接器销售规模从2005年30.8亿元增长到2009年的50.2亿元，我国已成为全球第三大连接器市场。

2005—2014年中国移动通信终端和数码产品精密连接器市场规模及增长



数据来源：赛迪顾问《2009-2010年中国电子产品五金零组件市场研究报告》

（二）精密电子零组件行业发展前景

1、国家政策的鼓励与支持

2006年5月，原国家信息产业部发布《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划（纲要）》（以下简称“《“十一五”纲要》”），明确提出新型元器件和半导体照明技术是国家未来5-15年重点发展技术。

同时，《“十一五”纲要》还瞄准电子元器件的发展方向，结合新型元器件门类多、技术复杂等特性，提出在国内现有元器件研制、生产技术基础上，突破目前行业发展迫切需要的微电子器件、光电子器件设计和制造的关键技术，努力发展微型化、薄型化、高精度、低功耗、多功能、复合化、组件化、模块化、智能化等特性的新型元器件作为重点发展项目。

继2000年把先进模具技术和精密成型技术列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》后，国家发展和改革委员会2005年12月颁布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》将电子专用设备、仪器、模具制造列入鼓励类产业，为进一步推动我国电子信息精密模具业的发展创造了良好的政策环境。

2009年4月国家颁布了《电子信息产业调整和振兴规划》（以下简称“《振兴规划》”），电子元器件被列入《振兴规划》中9大重大振兴领域，同时也被列入3个骨干产业。同时，《振兴规划》鼓励加速通信设备制造业大发展，加快第三代移动通信网络建设，带动系统和终端产品的升级换代。该规划将推动我国3G设备、无线设

备以及手机、数据卡、上网本等终端产品快速发展，为精密电磁屏蔽件、精密连接器创造广阔的下游应用市场空间。

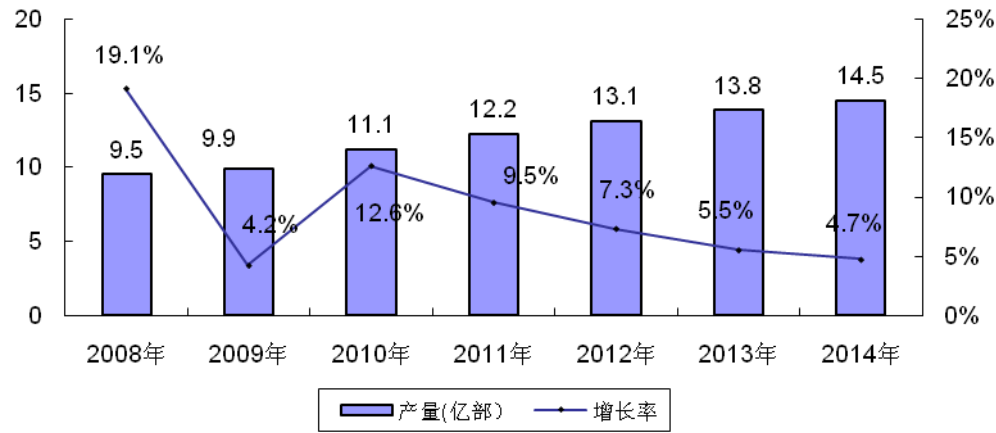
2009年10月12日，国家发改委、科技部、工信部、财政部、住房和城乡建设部、国家质量监督检验检疫总局联合发布《半导体照明节能产业发展意见》，重点重申了对半导体照明产业的扶持态度，提出“到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右；产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到20%左右，液晶背光源达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到70%以上”等目标。

根据《“十一五”纲要》、《振兴规划》的相关行业政策，新型精密电子器件是未来电子信息产业发展的重要方向。公司通过自主创新，掌握了精密电子零组件的设计和制造的关键技术，公司主要产品精密型电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨、贴片式LED精密支架等打破了美国、日本、台湾等国家或地区长期的技术垄断和市场垄断，是国家大力扶持和鼓励发展的高科技企业。

2、下游行业持续增长

未来几年，作为全球通信及数码产品的制造和研发中心，中国的移动通信终端及数码产品产量还将保持较快的增长速度，特别是全球数字技术、多媒体及无线移动应用所带来的产品升级市场将进一步带动通信终端及数码产品的生产规模扩张。

2008—2014年中国移动通信终端及数码产品产量规模及增长



数据来源：赛迪顾问《2009-2010 年中国电子产品五金零组件市场研究报告》

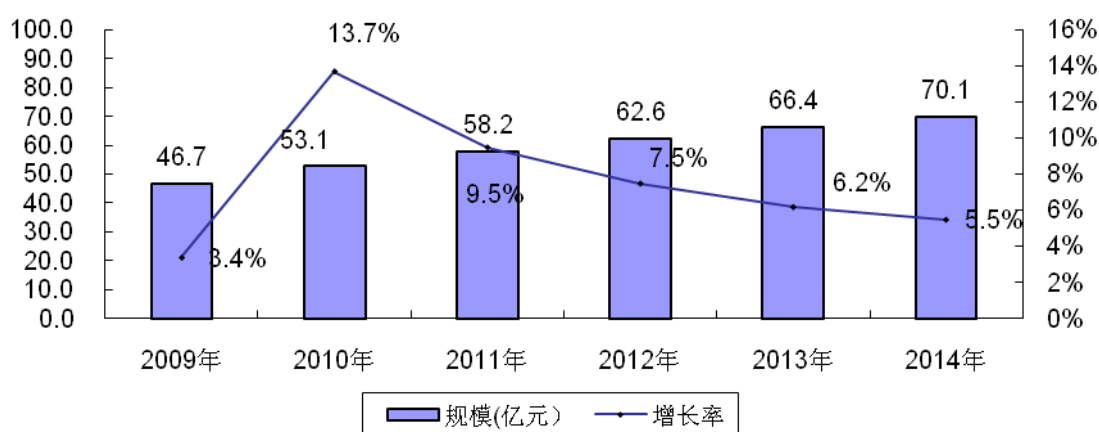
随着全球经济环境好转，消费者对电子产品支出增长，2010—2014年中国各类电子产品预计继续保持较快速度的增长。首先，在新兴市场和智能手机双重因素的推动下，全球手机市场将保持快速增长；其次，便携性的继续改善、市场价格的持

续走低和功能可以满足绝大部分用户的需求，笔记本对PC的替代性越来越强，全球笔记本市场也将迎来良好的发展；最后，各类创新的数码视听产品仍拥有众多的用户群体。中国作为全球最主要的手机、笔记本和数码产品生产大国，将受惠于全球电子产品市场的发展。

3、精密型电磁屏蔽件发展潜力巨大

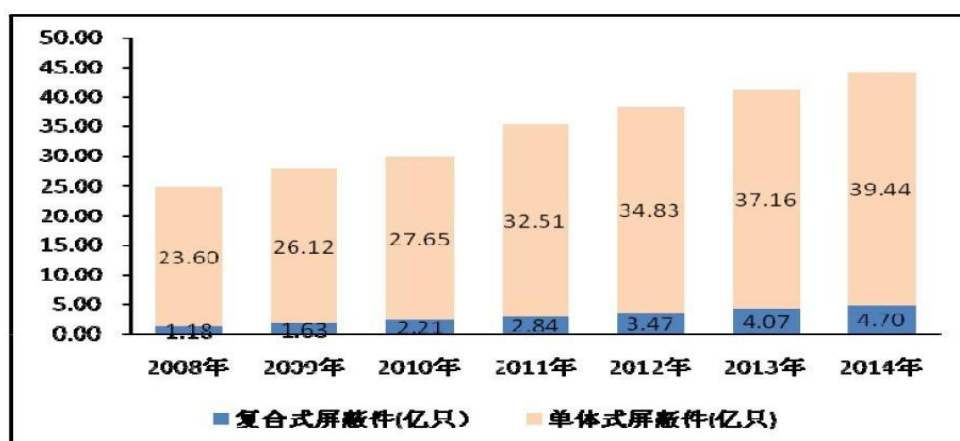
2009年中国移动通信终端电磁屏蔽件的销售规模达18.18亿元，2010年-2014年预计将保持8.4%以上的复合增长率。2009年中国手机和数据卡屏蔽件销量27.75亿只，其中单体式屏蔽件26.12亿只，复合式1.63亿只；随着触摸屏手机的普及，复合式屏蔽件将呈大规模增长态势，到2014年将超过4.7亿只。

2009—2014年我国精密型电磁屏蔽件销售额规模及增长



数据来源：赛迪顾问《2009-2010年中国电子产品五金零组件市场研究报告》

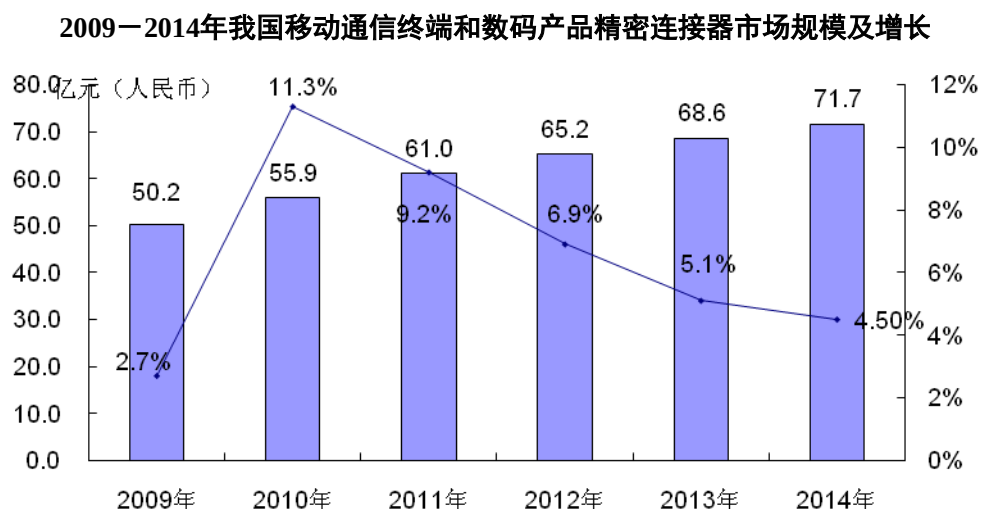
2009—2014年中国手机和数据卡电磁屏蔽件销量规模



数据来源：赛迪顾问《2009-2010年中国电子产品五金零组件市场研究报告》

4、精密连接器快速发展

移动通信终端和消费电子产品的多功能化带动了精密连接器需求大增，移动通信终端和消费电子产品性能阶梯式提升，创新性技术的应用带动产品功能的不断创新，专业化和融合将是未来全球移动通信终端和数码产品市场主要发展方向。产品性能呈多功能化发展，促使对精密连接器需求呈快速增长。预计2014年我国移动通信终端和消费电子产品市场精密连接器市场规模将达到71.7亿元。

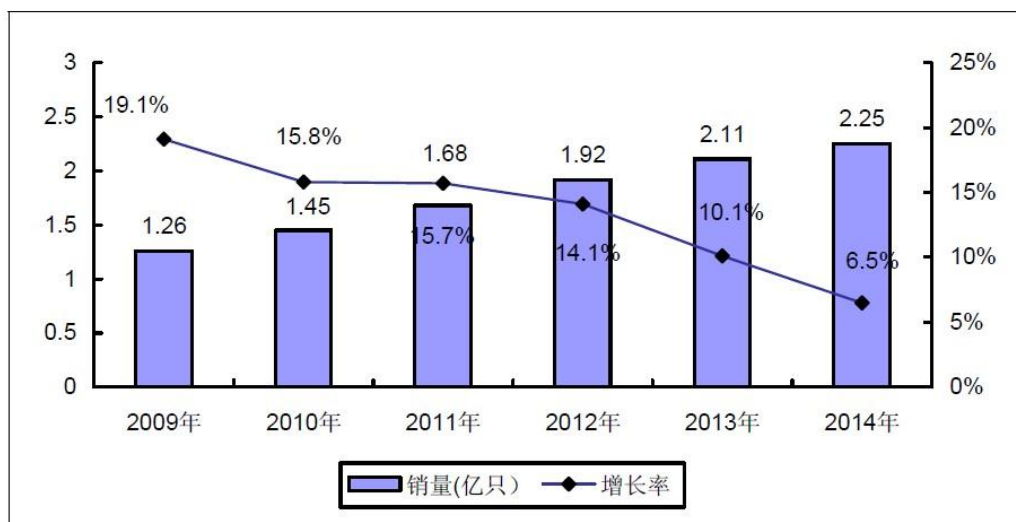


数据来源：赛迪顾问《2009-2010年中国电子产品五金零组件市场研究报告》

5、手机滑轨产品发展潜力巨大

手机滑轨是滑盖手机必要的零部件之一，随着滑盖手机市场规模不断扩大，手机滑盖销售量持续攀升，2009年手机滑轨全球市场销售额达到101.02亿元，同比增长7.4%；2009年中国市场手机滑轨销售额达到50.18亿元，同比增长速度达到13.3%；2009年中国手机滑轨市场销量规模将达1.26亿只，同比增长19.1%；手机滑轨市场规模在未来几年将保持较快增长，2014年预计将达到2.25亿只。

2009—2014年中国手机滑轨市场规模及增长



数据来源：赛迪顾问《2009-2010年中国电子产品五金零组件市场研究报告》

6、表面贴片式 LED 精密支架发展空间巨大

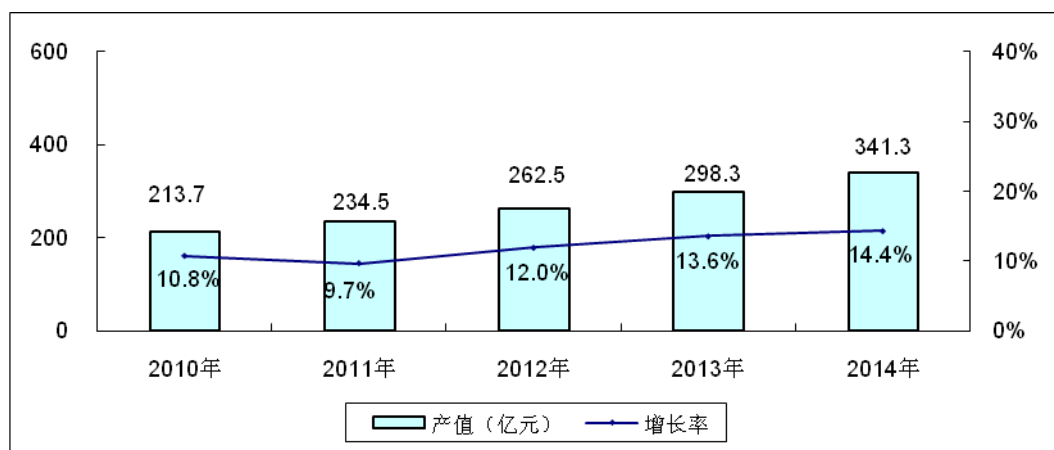
LED 技术是 21 世纪最引人瞩目的新技术领域之一，LED 照明作为一种高效节能环保的绿色固体光源将在未来迅速发展并得到广泛应用，并将成为继白炽灯、荧光灯之后第三代新光源。

2009 年，中国 LED 市场规模为 214.8 亿元，比 2008 年增长 15.9%，从数量上来看，2009 年中国 LED 市场需求量为 500.5 亿只，比 2008 年增长 16.7%

针对 LED 应用市场的需求量增长，相应的 LED 封装市场增速也随之加快，尤其是 SMD 和大功率 LED 封装增长更为迅速，也逐渐成为 LED 封装市场的主流趋势 2009 年 LED 市场需求额达到 211.0 亿元，比 2008 年增长 13.8%。

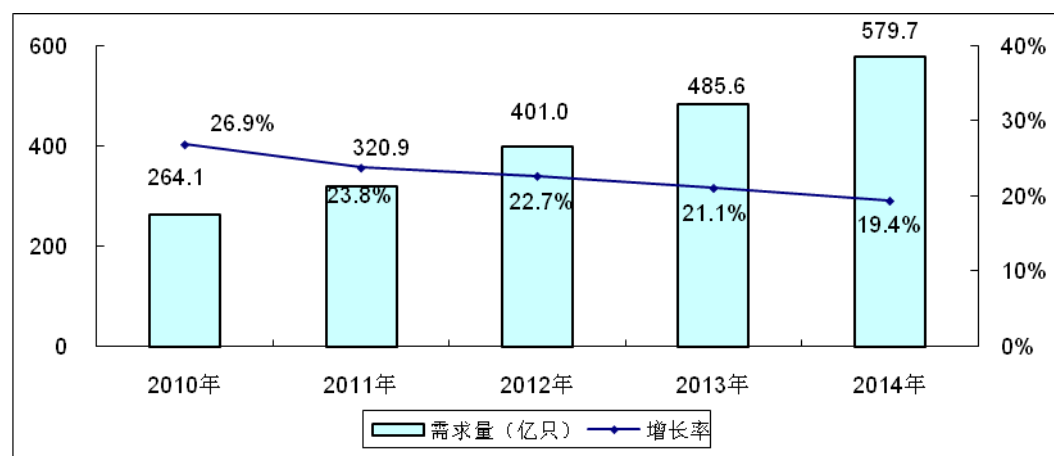
随着景观照明、LED 路灯以及大尺寸背光源应用的逐步增多将带动 LED 平均价格的上升，2014 年中国 LED 市场需求额将达到 341.3 亿元，从数量上看，贴片式 LED 支架在 2010 年我国的需求量为 264.1，到 2014 年将达到 579.7 亿只。

2010—2014年中国LED封装产业规模预测（产值）



数据来源：赛迪顾问《2009-2010 年中国 LED 市场研究年度报告》

2010—2014年中国贴片式LED精密封装支架市场需求量预测



数据来源：赛迪顾问《2009-2010 年中国 LED 市场研究年度报告》

三、发行人的成长性分析

（一）内在因素分析

1、产品设计优势

截至 2009 年末，公司拥有研发人员 110 名，其中产品设计师 91 人。产品设计团队对电子信息行业的市场变化趋势、技术进步、公司生产能力及下游客户需求有深刻的理解和把握，设计师均具有丰富的电子零组件产品设计经验，能娴熟地应用 pro/E、CAD 和模流分析等电脑辅助工具软件高效工作。2009 年，公司共设计精密型

电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨、表面贴装式 LED 精密支架等新产品达到 1,092 款。公司凭借业内领先的产品设计开发技术、精密模具设计开发技术，具备与下游客户共同研究、确定设计方案，共同制定产品技术标准，并与下游客户同步设计的能力，提高了产品设计水平。公司通过自主创新，设计了多种精密电子零组件新产品，其中复合式屏蔽件、表面贴装式 LED 精密支架、旋转式滑轨和大行程大推力手机滑轨等，均属于创新型设计，更是发挥出引领市场需求的作用。

2、产品创新优势

公司自成立以来，一直以产品创新作为企业发展的首要任务，成立了技术开发中心，每年将销售收入的 8% 左右用于新产品开发。在电磁屏蔽件产品创新方面，2004 年在中国本土企业中率先开发出用于移动通信终端和数码产品的精密型电磁屏蔽件；2008 年在中国本土企业中率先开发出用于移动通信终端和数码产品的复合式电磁屏蔽件。在连接器产品创新方面，2004 年开发出移动通信终端和数码产品精密连接器；2007 年打破国外企业垄断，开发出移动通信终端和数码产品用的微射频连接器；2007 年在中国本土企业中率先实现用于移动通信终端和数码产品连接器品种的系列化。2009 年在中国本土企业中率先开发出表面贴装式 LED 精密支架和旋转式滑轨，并开始进入批量化生产和销售。

围绕着上述产品的开发，公司持之以恒地进行核心技术的研发，先后实现了多项技术的突破，包括：①通过对超精密模具零件加工技术的攻关，使模具加工精度由 5 μ m 提升到 2 μ m，达到国际先进水平；②打破国外材料选用模式，应用金属材料替代工程塑料，开发出大推力大行程超薄型弹簧模组；③开发出小间距多料带冲压技术；④通过计算机模流分析和注塑工艺革新，掌握了在 49mm $\times$ 96mm 的面积上可一模射出两百只微型模内注塑技术。

截至 2009 年底，公司共申请 31 项专利技术。2009 年 1 月，微小型精密手机连接器被评为“深圳市自主创新产品”；2009 年 5 月，通信及数码产品屏蔽件被评为“深圳市科技成果”。

近三年，公司新产品开发量大幅度增长，2007 年、2008 年和 2009 年分别开发新产品 459 款、683 款和 1,092 款，年复合增长率达到 50% 以上，其中手机和数据卡精密型电磁屏蔽件新产品开发量位居全球第一。因公司在产品创新方面取得突出成

绩，2008 年，公司荣获“国家级高新技术企业”称号和“深圳市自主创新行业龙头企业”称号，2009 年，公司荣获“深圳市 2009 年度自主创新百强中小企业”称号。

3、精密模具开发优势

公司是中国模具工业协会会员，是深圳市机械行业协会模具专业委员会理事单位。公司精密模具开发实力强大，拥有一支60余人的专业模具设计师团队。在小型精密五金高速连续冲压模具方面优势明显，2009年开发该类模具1,830套，位居全球第三；在精密五金模具方面，公司能够开发精度较高的多工位连续级进模、拉伸模、小间距多料带模，最高可达1100次/分，寿命可达3亿冲次以上，模具全部采用日本、德国的连续高速级进冲压模具结构制式，在国内领先地位；在塑胶模方面，以开发微小型精密塑模为主，能够开发立式注塑模、卧式注塑模、模内注塑模。立式注塑模、卧式注塑模一模可出16件或32件，具有国内行业先进水平，适合生产各种微小轻薄的产品。微型模内注塑模是为贴装式LED精密支架产品而专门攻关开发的，精密度更高，关键零件精度达 $\pm 1\mu\text{m}$ ，为国际先进水平，模具开发周期最短可达8天。

截至2009年末，公司拥有157台套的进口模具加工设备，100多台精密测量设备，从事模具零件加工和模具组立等的技工技师达到500多人，具备月产精密级进模180套、精密塑胶模50套的制造能力，强大的精密模具开发能力为精密电子零组件的开发生产提供保证。

4、精密制造技术优势

公司拥有高端精密的生产设备、经验丰富的技术工人、成熟精湛的技术工艺、高效严格的现场管理等生产要素，拥有各类产品生产所需的精密模具开发、精密冲压、精密射出成型、激光焊接应用、产品测量、自动化生产装备设计开发、环保清洗应用、一体化攻牙、实验与测试等全工艺生产技术，确立了公司在行业内的精密制造技术优势。公司将精密模具开发制造优势与精密制造优势有机的结合起来，形成了强大的精密电子零组件产品整体制造优势。

5、大客户优势

服务于大客户并与大客户共同成长，是公司的重要发展战略，也是公司的竞争

优势所在。公司始终瞄准国际国内一流品牌客户发展业务，现已成为三星、华为、中兴通讯、联想、海尔、海信、TCL-阿尔卡特、宇龙酷派、比亚迪、天语、国虹、金立和好易通等二十多家国内外知名大客户的紧密合作伙伴。上述核心客户的产品系列较为广泛，精密电子零组件需求量大，为公司未来业绩增长提供了充分保障。

6、响应速度优势

对于下游客户80%左右的新产品开发和供货要求，公司能在2天内完成模具设计，8天内完成模具制作，最快10天内投入量产，从模具设计到批量生产周期通常为20天，远高于30-40天的行业平均水平。对于时间较紧的特殊订单，公司建立了绿色通道制度，充分调动公司的设计、生产资源，适应客户快速推出的新产品计划。公司的响应速度优势，确保公司能够紧跟下游客户的产品更新换代的步伐。

7、成本优势

公司采取全工艺、全制程、内部垂直整合的生产模式，公司产品生产所涉及的前期研发、产品设计、模具零件加工、精密冲压、精密射出成型、自动化组装设备开发、自动化组装、包装材料、产品测试等生产制程均由公司自主完成。这种垂直整合的生产模式不仅有利于控制公司产品品质、保证产品的按期交付，也确立了公司的成本优势。

（二）发行人的成长指标分析

1、发行人近三年期财务数据的成长性

（1）资产增长

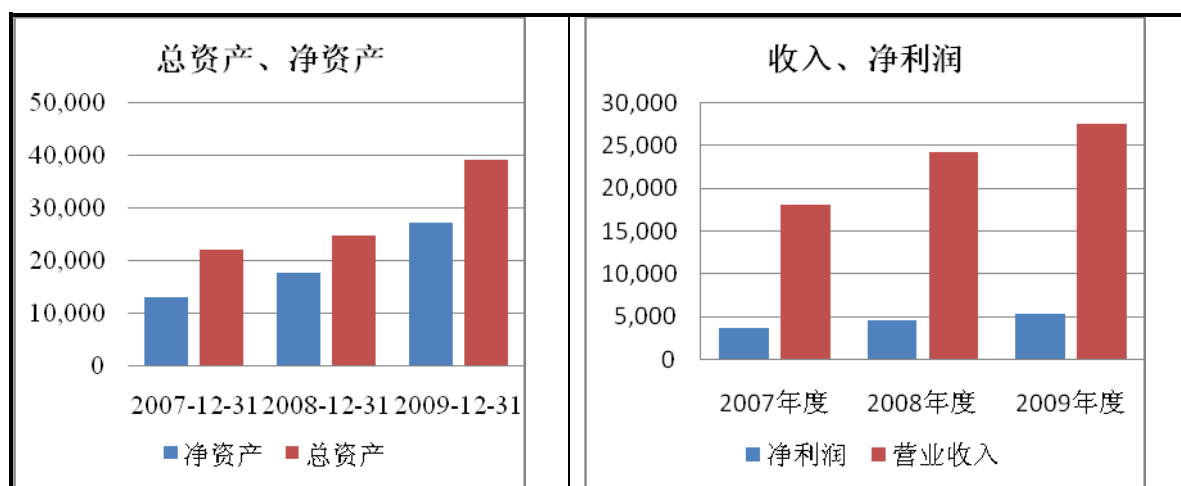
报告期内，发行人规模不断扩大，资产持续增长，成长性明显：

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日
	金额 (万元)	同比增长 (%)	金额 (万元)	同比增长 (%)	金额 (万元)
总资产	38,940.25	57.71	24,722.53	12.59	21,957.46
净资产	27,089.69	53.77	17,616.46	35.03	13,046.37

报告期内各期末，公司资产总额分别较上年末增长了 14,217.72 万元、2,765.08 万元，增长率分别为 57.51%、12.59%，资产规模的增长提高了公司的风险应对能力。

引起公司资产总额增长的主要因素包括：①报告期内公司累计实现净利润 13,777.46 万元，扣除分红后的盈余积累 12,877.46 万元；②报告期内，新进入股东累计对公司投入资金 12,870.00 万元。

公司为精密制造型企业，为扩大产能、满足客户需求，报告期内，公司持续增加对高端设备的投入，新增设备投资 6,306.28 万元；为积极开拓长三角市场，公司投资成立全资子公司昆山长盈，并支付购地、建造厂房支出 2,567.46 万元。非流动资产由 2,873.47 万元增长至 8,255.85 万元，占总资产的比重由 13.09% 增长至 21.20%。非流动资产的增加扩大了公司的业务规模、改善了公司的生产经营条件，为公司的更大发展奠定了坚实基础。



(2) 收入、利润增长

在规模不断扩大，资产持续增长的同时，发行人营业收入及利润也快速增长：

项 目	2009 年度		2008 年度		2007 年度
	金额 (万元)	同比增长 (%)	金额 (万元)	同比增长 (%)	金额 (万元)
营业收入	27,603.19	13.31	24,361.01	34.21	18,151.47
净利润	5,423.23	17.40	4,619.53	22.03	3,785.72

报告期内，公司各类产品销售情况良好，均呈现良好的增长态势。公司的业务收入由 2007 年的 18,151.47 万元增长至 2009 年 27,603.19 万元，增长幅度为 52%。2008 年、2009 年公司业务收入增长速度分别为 34.21% 和 13.31%。其中，电磁屏蔽

件的快速增长是公司营业收入增长的主要来源，屏蔽件销售收入由 2007 年末的 7,601.70 万元增至 2009 年 13,977.36 万元。

2009 年，公司根据“规划一代、储备一代、开发一代、量产一代”的产品开发策略，成功开发并顺利量产 LED 光电支架、滑轨等产品，因 LED 光电支架、滑轨产品的巨大市场需求，为公司未来业务增长提供了保证。

2009 年，公司营业收入增长速度放缓的主要原因为原材料采购成本下降引起产品销售价格的下降。2008 年，铜带、不锈钢等主要金属原材料价格高位运行，产品市场价格也处于较高水平；2009 年受主要金属原材料价格下降的影响，公司也对产品价格进行了相应调整，调整幅度低于原材料价格下降幅度，同时，公司通过不断创新，推出具有更高附加值的新产品，是公司综合毛利率保持较高水平，并呈上升趋势。

（3）主要利润来源分析

①公司主要利润来源科目分析

项目	2009 年度		2008 年度		2007 年	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
营业利润	6,127.27	96.84	5,152.83	96.88	4,040.14	99.27
营业外收支净额	199.88	3.16	165.49	3.12	29.78	0.73
利润总额	6,327.15	--	5,318.32	--	4,069.92	--

报告期内，公司营业利润占同期利润总额的 99.27%、96.88%和 96.84%，主营业务利润是公司利润的主要来源。公司盈利对于关联方或不确定的客户不存在依赖，也不依赖于对外投资收益等非经常性损益项目，盈利具有连续性和稳定性。

②公司主要产品利润来源分析

单位：万元

产品类别	2009 年度		2008 年度		2007 年	
	毛利额	占比 (%)	毛利额	占比 (%)	毛利额	占比 (%)
电磁屏蔽件	6,898.13	66.27	5,312.00	58.05	2,896.31	46.90
连接器	3,206.43	30.80	3,704.90	40.48	3,192.36	51.70

产品类别	2009 年度		2008 年度		2007 年	
	毛利额	占比 (%)	毛利额	占比 (%)	毛利额	占比 (%)
LED光电支架	1.87	0.02	--	--	--	--
手机滑轨	91.99	0.88	--	--	--	--
其他	210.97	2.03	134.61	1.47	86.66	1.40
合 计	10,409.38	100.00	9,151.51	100.00	6,175.33	100.00

报告期内，公司主导产品电磁屏蔽件、连接器构成公司的主要利润来源。随着公司研究开发能力的提升、生产装备的改善，公司在产能有限的前提下，逐步向具有更高附加值的高端产品转移产能，更侧重于工艺复杂的复合型电磁屏蔽件产品生产。2007-2009 年，公司电磁屏蔽件产品所提供的毛利额由 2,896.31 万元增长至 6,898.13 万元，增长 2.38 倍。

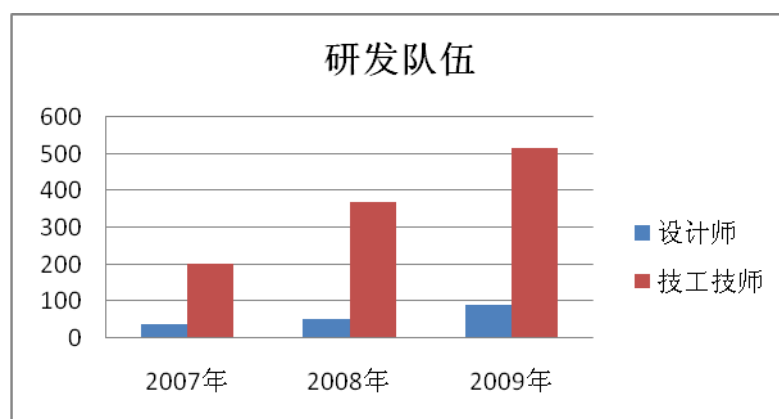
公司受产能不足的限制，在连接器类产品上注重产品结构的调整，增大具有较高毛利水平的卡类连接器、RF 连接器的比例，使连接器产品毛利保持稳定，最近三年毛利分别为 3,192.36 万元、3,704.90 万元和 3,206.43 万元。

公司作为以精密模具制造为核心，注重产品创新、技术创新的制造型企业，不断推出更高精度和代表更高制造工艺水平的精密零组件产品，为公司盈利提供充分保障。2009 年 10 月，公司的手机滑轨、LED 光电支架等产品开发成功、量产，将成为公司新的利润来源。

2、发行人研发技术能力的持续增强

(1) 研发队伍不断扩大，实力不断增强

近年来，发行人研发队伍不断扩大，截至 2009 年 12 月 31 日，发行人拥有设计师、技工技师人员 607 名，一半以上拥有在国内外知名企业工作经验。



2008 年，公司荣获“深圳市自主创新行业龙头企业”称号和“国家高新技术企业”称号；2009 年，公司荣获“2009 年度自主创新百强中小企业”称号，并成为中华全国工商业联合会直属会员企业，发行人研发实力不断增强。

(2) 研发投入持续增长

报告期内，公司研发投入的具体情况如下：

项 目	2009 年	2008 年	2007 年	合计
研发投入（万元）	2,430.37	2,162.64	741.59	5,334.60
销售收入（万元）	27,603.19	24,361.01	18,151.47	70,115.67
研发投入/销售收入	8.80%	8.88%	4.08%	7.61%

公司历来重视技术研发，在研发方面的投入逐年增加，近三年研发费用（不含形成资产部分）占销售收入的比例为 7.61 %。2009 年公司的研发费用超过 2,400 万元，近二年研发费用占销售收入的比例保持在 8 %以上。技术研发是制造类企业在市场竞争中赖以生存的根本，公司将不断加大在研发方面的投入，确保公司在精密零组件行业的技术领先地位，增强产品的竞争力，拓展公司的服务领域。

(3) 研发成果不断涌现

自公司成立以来，一直以产品创新作为企业发展的首要任务，成立了技术开发中心，每年将销售收入的 8%左右用于新产品开发。发行人研发成果不断涌现，已获得专利技术 23 项，另有已受理的专利申请 8 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 5 项，拥有多项非专利技术项。

在电磁屏蔽件产品创新方面，2004 年在中国本土企业中率先开发出用于移动通信终端和数码产品的精密型电磁屏蔽件；2008 年在中国本土企业中率先开发出用于

移动通信终端和数码产品的复合式电磁屏蔽件。在连接器产品创新方面，2004 年开发出移动通信终端和数码产品精密连接器；2007 年打破国外企业垄断，开发出移动通信终端和数码产品用的微射频连接器；2007 年在中国本土企业中率先实现用于移动通信终端和数码产品连接器品种的系列化。2009 年在中国本土企业中率先开发出贴片式 LED 精密支架和旋转式滑轨，并开始进入批量化销售。

近三年，公司新产品开发量大幅度增长，2007 年、2008 年和 2009 年分别开发新产品 459 款、683 款和 1,092 款，年复合增长率达到 50%以上，其中手机和数据卡精密型电磁屏蔽件新产品开发量位居全球第一，确立了公司的产品创新优势。

3、发行人核心客户群不断增加

公司与众多高端客户业已建立起来的良好互信合作关系，核心客户群不断增加，是公司未来持续经营的有力保障。公司依靠垂直整合的生产程序、快速的响应速度、较高的产品质量、完善的售后服务持续进行市场开拓工作，通过了华为、中兴、三星等二十余家下游行业知名品牌企业的质量认证并成为其合格供应商，为公司业务规模及业务收入的持续增长提供了合理保证。

服务于大客户，与公司大客户共同成长，是公司的既定战略。公司还将继续进行大客户开拓工作，形成公司新的收入增长来源。对已进入的客户，提高公司产品的覆盖面和产品线深度，取得更多的产品订单。

（三）发行人具备持续分享行业高增长的相关保障及措施

1、发行人已取得行业领先地位

（1）发行人的行业地位

相对于行业内的其他企业，发行人整体实力、盈利能力处于前列，行业地位详述如下：

①精密电子零组件产品技术领先型企业

移动通信终端和数码产品精密电子零组件的产品起源于美国、日本、德国等发达国家，并在近十年得到广泛应用，形成了泰科、莫仕、莱尔德、安费诺等全球性的生产厂商。公司主要与上述行业内企业展开竞争，发行人是国内领先的专业从事

电子信息产业精密零组件的开发、设计、生产和销售的先进制造企业，为客户提供移动通信终端产品、数码产品和光电产品的精密电子零组件。

2009 年 1 月，微小型精密手机连接器被评为“深圳市自主创新产品；2009 年 5 月，通信及数码产品屏蔽件被评为“深圳市科技成果”。

②发行人整体实力在行业中位居前列

发行人成立以来，主营业务收入和净利润一直保持稳健、快速增长，已经成长为具有清晰的战略定位、完善的法人治理结构、优秀的文化和团队、健全的业务流程和制度的高新技术企业。“长盈精密”在行业内具有较高的品牌知名度与美誉度，发行人在产品设计、模具开发、技术应用的前瞻性，综合应用研究方面积累形成了一支年轻有实力的研发队伍，具备优越的技术优势。

（2）发行人的市场占有率

发行人开发制造的用于手机和数据卡精密型电磁屏蔽件新产品开发量位居全球第一，市场份额中国本土企业第一；发行人开发制造的用于移动通信终端的精密连接器产品，在中国本土企业中，产品品种最全，并成为国内品牌手机生产企业的主导供应商；发行人开发制造的表面贴装式 LED 精密支架产品是中国本土企业中最早研发成功的，并最先实现规模化生产；发行人是中国本土企业中最早开发成功大推力大行程手机滑轨弹簧模组的企业。发行人开发制造的正向滑动、侧向滑动、旋转滑动和曲面滑动等滑轨产品，达到国际先进水平；发行人 2009 年开发小型精密五金高速连续冲压模具 1,830 套，开发量位居全球第三。

（3）产品良好的市场前景

公司手机滑轨技术和产业化发展，突破了美国安费诺、莱尔德两家国外厂商的市场垄断，形成规模化生产、销售，部分产品起到引领市场的作用。滑盖手机作为手机的主要形式之一，得到消费者的广泛认可，预计滑盖手机在未来一段时间保持较高增长趋势，手机滑轨具有良好的市场前景。手机滑轨产品的进口替代给国内手机滑轨生产厂商带来重要商机。

LED 产业作为国家重点扶持的低碳产业，在未来将保持较快增长速度。作为 LED 产品的重要组成部分，表面贴装式 LED 精密支架因其产品精度高，工艺复杂，目前

主要由日本东洋电波、益能达和台湾一詮等外企供货。作为最早规模化参与这一领域竞争的本土企业，具有良好的市场前景。

2、发行人持续增长的相关措施

（1）发行人制订了清晰的战略定位和明确发展规划

未来三年，公司将紧扣新型精密电子零组件领域，实施多品种经营战略和内部垂直整合提升竞争力战略，实现公司长期可持续发展，保持业务和盈利持续增长，给股东和投资者提供长远稳定的回报。

发行人计划通过加强研发投入，继续保持发行人在该领域的技术领先优势，掌握新产品设计、开发、高精度模具开发等精密电子零组件领域各项核心技术，不断开发新产品，拓展应用领域，提升自主创新能力；通过业务领域的拓展和营销网络的建设提升，打造持续领先的综合竞争优势和可持续发展能力；通过国际市场的拓展，实现国际化经营，寻找新的利润增长点，争创国际知名品牌。

（2）发行人研发管理体制不断完善

发行人已形成日趋完善的研发管理体制，公司的技术中心下设五金产品开发设计部、滑轨产品开发设计部、连接器产品开发设计部、SMD 产品开发设计部、实验测试室、知识产权办公室、经费管理办公室等部门。

（3）募投项目的实施将进一步强化发行人的竞争优势，增加成长性

以上海、昆山为代表的长三角地区是中国三大电子产品制造集群的中心之一，被誉为我国著名的“电子信息产业走廊”，移动通讯终端产量占全球产量的 1/8，笔记本电脑占全球产量的 1/3，数码相机占全球产量的 1/8，GPS 导航仪占全球产品的 3/5，宏达电（HTC）、华硕、华宝、华冠、英华达，RIM（黑莓）等著名的手机和笔记本电脑厂商均在长三角地区设立生产基地或采购中心，产业集聚效应促使长三角地区成为上游精密电子零组件行业最为发达、科技含量最高、市场容量最大的区域之一。同时，长三角地区、环渤海地区也是我国新兴的 LED 产品制造基地。2007 年-2009 年，发行人在华东地区的销售金额分别为 1,726.77 万元、2,577.07 万元和 4,175.33 万元，占同期营业收入的比例分别为 9.51%、10.57%、15.13%，销售收入增

长率分别为 49.20%和 62.02%，呈加速增长趋势。随着长三角地区业务量的大幅度增加，保持及时的信息沟通、同步研发合作和及时供货能力的在日常经营中地位逐渐突出。为了更好的服务于客户，实现就近生产、贴近服务，建立完善的紧密型生产合作模式，由昆山长盈实施募投项目，将昆山长盈打造成为发行人新的制造及服务平台，使发行人的产能布局从珠三角地区拓展到长三角地区，同时辐射到诺基亚、LG、索尼爱立信、摩托罗拉等国际著名移动通信厂商的生产基地所在地——以北京、天津为代表的环渤海地区，为发行人未来 2-3 年全面进入诺基亚、LG、索尼爱立信、摩托罗拉、宏达电（HTC）、英华达、RIM（黑莓）等国际知名厂商以及中宙等众多的 LED 封装制造企业的发展目标打下良好基础。

发行人拟定了“生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目、生产表面贴装式 LED 精密封装支架项目和生产手机及数码产品滑轨项目”三个募集资金投资项目。

本次发行募集资金投资项目符合发行人主营业务的发展方向，募集资金投资项目将在遵循发行人现有的采购模式、生产模式和销售模式的基础上，使发行人的产品设计能力、模具开发能力、生产能力、营销网络的服务水平、自主创新能力将得到较大的提升，技术领先优势将得到巩固和强化，核心竞争力和盈利能力也将得到进一步提升。

本次募集资金投资项目具备较好的盈利前景，根据募集资金项目的可行性研究报告，项目达产后每年约可增加营业收入 57,500 万元。

（4）严格的订单评估程序，市场化定价，确保毛利及净利润增加

公司执行市场化定价政策，在与客户进行定价协商时，公司严格执行订单评估程序。公司与客户协商订单或进行投标时，由市场销售部门、产品开发部门、财务部门分别进行订单评估，在考虑定单的收入、材料采购成本、产品加工费用以及公司的合理盈利等情况后决定是否接受订单或确定是否投标报价。订单评估程序能够应对材料成本变动对公司经营的影响，使公司的毛利率保持在合理区间，从根本上保证公司的盈利水平。

2008 年下半年受金融危机影响，铜带、不锈钢等主要金属原材料价格回落，2009 年上半年原材料价格保持相对低位运行，公司根据原材料价格的调整对产品价格进行了相应调整，影响了公司 2009 年营业收入的增长速度。随着全球经济企稳向好，

公司主要原材料价格均大幅上涨并高位运行，公司根据价格上涨情况即时调整了对外产品报价，有利于保持公司的业务收入增长。

市场化定价，严格的订单评估，公司未来将保持在业内较高的毛利率水平，公司未来毛利及净利润将呈逐步增加的态势，对公司未来成长性将产生积极的影响。

四、发行人的自主创新能力分析

（一）发行人目前具备的自主创新元素

1、发行人自主研发的新产品

自公司成立以来，一直以产品创新作为企业发展的首要任务，成立了技术开发中心，每年将销售收入的 8% 左右用于新产品开发。在电磁屏蔽件产品创新方面，2004 年在中国本土企业中率先开发出用于移动通信终端和数码产品的精密型电磁屏蔽件；2008 年在中国本土企业中率先开发出用于移动通信终端和数码产品的复合式电磁屏蔽件。在连接器产品创新方面，2004 年开发出移动通信终端和数码产品精密连接器；2007 年打破国外企业垄断，开发出移动通信终端和数码产品用的微射频连接器；2007 年在中国本土企业中率先实现用于移动通信终端和数码产品连接器品种的系列化。2009 年在中国本土企业中率先开发出贴片式 LED 精密支架和旋转式滑轨，并开始进入批量化销售。

近三年，公司新产品开发量大幅度增长，2007 年、2008 年和 2009 年分别开发新产品 459 款、683 款和 1,092 款，年复合增长率达到 50% 以上，其中手机和数据卡精密型电磁屏蔽件新产品开发量位居全球第一，确立了公司的产品创新优势。

2、发行人已取得的技术创新成果

发行人自成立以来一直重视技术创新，特别是核心技术的积累。已获得专利技术 23 项，另有已受理的专利申请 8 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 5 项。此外，发行人拥有多项非专利技术。

2008 年，发行人被评为“国家级高新技术企业”、“深圳市自主创新行业龙头企业”、“深圳市工业 500 强企业”、“深圳市宝安区民营中小企业成长计划工程企业”、“深圳市宝安区绿色环保示范企业”，2009 年成为“中华全国工商业联合会直属会员”，并

多次获得客户授予的“合格供应商”、“优秀供应商”、“卓越供应商”、“商业合作伙伴”等荣誉称号。

(1) 已取得的专利技术

序号	专利名称	专利号	类型
1	手机尾部用 I/O 连接器	ZL200420046547.7	实用新型
2	连接器(板对板)	ZL200730132856.5	外观设计
3	记忆卡连接器	ZL200720120124.9	实用新型
4	记忆卡连接器	ZL200720120123.4	实用新型
5	连接器	ZL200720120121.5	实用新型
6	连接器	ZL200720120120.0	实用新型
7	连接器	ZL200720120122.X	实用新型
8	记卡连接器	ZL200730132038.5	外观设计
9	HDMI 母端连接器	ZL200720172749.X	实用新型
10	数据传输连接器	ZL200720172748.5	实用新型
11	手机用支撑板	ZL 200820095414.7	实用新型
12	一种手机用滑盖板	ZL 200820095415.1	实用新型
13	一种手机用屏蔽罩	ZL 200820146912.X	实用新型
14	一种带 SIM 卡连接器的屏蔽架	ZL 200820147395.8	实用新型
15	一种双层 SIM 卡连接器	ZL 200820212244.6	实用新型
16	用于制造 SIM 卡座的端子排及用该端子排制造的卡座	ZL 200920135078.9	实用新型
17	一种滑盖手机用滑块模组	ZL200920153313.5	实用新型
18	一种滑动、翻盖手机用的连接件及用该连接件制成的手机	ZL200920153283.8	实用新型
19	一种滑盖手机用弹簧模组	ZL200920008112.6	实用新型
20	一种 USB 接口母端连接器	ZL200920135618.3	实用新型
21	一种 USB 接口母端连接器	ZL200920135617.9	实用新型
22	一种用于生产电池连接器的公头料带和母头料带以及用其制造的电池连接	ZL200920135619.8	实用新型
23	一种滑盖手机用滑块模组	ZL200920162567.3	实用新型

(2) 正在申请过程中的专利技术

序号	专利名称	申请号	类型
1	一种滑盖手机用弹簧模组	200910134557.3	发明专利
2	一种滑盖手机用滑块模组	200910166262.4	发明专利
3	一种滑盖手机用金金属弹簧模组	200910209865.8	发明专利
4	一种 LED 支架	200920162568.8	实用新型
5	一种 LED 支架	200920162569.2	实用新型
6	一种高效 LED 支架	200920270033.2	实用新型
7	一种滑盖手机用金属弹簧模组	200920270034.7	实用新型
8	一种四点 LED 支架及采用该支架制成的 LED 光源	200920261460.4	实用新型

(3) 非专利技术

公司拥有产品设计开发技术、精密模具设计开发技术、精密冲压技术、激光焊接应用技术、一体化攻牙技术、精密弹簧模组开发技术、精密射出成型技术、微型模内注塑技术、LED 支架自动一体化生产技术、环保清洗应用技术、自动化组装设备开发应用技术、自动化检测与包装技术、精密测量技术、自动检测技术等非专利技术。

3、发行人在产品和技术方面持续创新的保障机制

(1) 发行人已建立了完善的研究开发体系

公司共有研发人员 110 名，其中产品设计师 91 人。专业技工技师人员 500 多人，占公司员工总数的 25%以上，90%以上具有大专以上学历，公司研发人员大部分从国内外行业知名企业引进的人才，具有较丰富的开发设计经验，具备与客户同步设计的能力和自主开发能力。

通过对下游产品发展趋势的研究，寻找新的产品开发线索；通过与客户的研发人员共同确定研发的新产品，按照客户的要求进行定向开发。为规范新产品开发作业流程，促进新产品管理制度化，提高工作效率，公司制订了《新产品开发管理办法》。为保证研发项目目标的实现，在立项及研发过程中，项目组成员和项目评估小组吸收有关市场和财务人员及专家参加，以便及时传递市场压力，实施有效的成本控制，并通过定期报告，定期评审验收，实行全过程控制。

为充分调动研发人员的积极性，发挥专业人才的聪明才智，提升市场竞争力，研发中心制订了《精密五金产品研发人员绩效奖励办法》、《精密连接器产品研发人员绩效奖励办法》、《贴装式LED精密支架研发人员绩效奖励办法》等奖励办法，和研发相关配合部门也制订了系列化奖励措施。增强研发人员开发创新产品的活力，调动了人员的积极性，提高研发效率。

公司高度重视知识产权管理、保护工作，专门成立了知识产权办公室，并成立知识产权工作领导小组，制定了《知识产权管理规定》、《专利检索作业管理办法》、《专利申请奖励作业管理办法》、《专利申请作业管理办法》。在每年四月份确定为《专利法》宣传活动月，采用多种形式使每位员工理解知识产权的相关知识及其重要性。

（2）发行人在精密电子零组件相关领域有深厚的技术积累

公司致力于技术的研发和自主创新，近年来，公司通过不断建立和完善研发体系，加大研发投入，提高技术创新能力，掌握了本行业主要生产技术，具备研究开发较高水平的新产品、新技术、新工艺的能力，也具备了将先进技术应用于产品并且实现工业化、规模化生产的实力。

1、产品设计技术

公司拥有研发人员 110 名，其中产品设计师 91 人。产品设计团队对市场流行趋势、技术进步、公司生产能力及下游客户需求有深刻的理解和把握，设计师均具有丰富的电子零组件产品设计经验，能娴熟地应用 pro/E、CAD 和模流分析等电脑辅助工具软件高效工作。2009 年，公司共设计精密型电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨、表面贴装式 LED 精密支架等新产品达到 1,092 款，公司凭借较强的产品设计开发技术、精密模具设计开发技术，具备与下游客户共同研究、确定设计方案，共同制定产品技术标准，具备与下游客户同步设计能力，提高了产品设计水平。公司通过自主创新，设计了多种精密零组件新产品，其中复合式屏蔽件、表面贴装式 LED 精密支架、旋转式滑轨和大行程大推力滑轨，均属于创新型设计，起到了引领市场需求的作用。

2、精密模具设计开发技术

公司拥有国内一流的模具设计、模具零件加工、模具组立专业人才，配置了先

进的模具加工设备和检测设备（包括精密磨床、光学磨床、慢走丝、精密火花放电、二次元、三次元、投影仪等），所设计的加工模具结构先进、精度高、稼动率高。公司自成立以来专注于精密模具相关技术的研究、运用，重视模具产品制作的标准化和精确度，利用pro/E、CAD电脑辅助工具软件以提高模具精度、对德国、瑞士、日本等国家的模具钢材料及热处理工艺进行分析研究，选择出适应电子精密零组件特点所需的高性价比的模具钢材料，延长了模具寿命、提高了生产效率、减少了调试模时间、降低了模具制造成本，在优良的技术平台上实现设计、加工、制造的完美结合。

3、精密冲压技术

在冲压设备上，公司拥有国际先进的进口高精度高速冲床成套设备（最高冲速达1,100次/分钟）99套。在冲压方式上，采用世界先进的高速连续进料和多带进料的冲压方式，与传统冲压方式相比，生产效率提高百倍以上，也提高了材料的利用率。精密冲压五金模具采用铝合金模座、自润化、滚动导柱及双料带输送结构，生产效率达到行业内领先水平。在冲压精度上，可冲制产品精度达到 $\pm 5\mu\text{m}$ ，冲制产品达到高度的一致性和稳定性，达到国际先进水平。

4、精密射出成型技术

精密射出成型加工是一项综合性很强的专业制造技术，掌握高水平的塑胶模具设计技术、精密塑胶模具制造技术、先进的注塑工艺技术，配置高精度的精密塑胶注塑机，才能保证产品所需的精度。

在精密射出技术方面，公司生产的移动通信和数码产品连接器可实现一模出32件的精密射出技术，达到国内行业先进水平，适合各种微小轻薄的产品。微型模内注塑技术实现了创新性开发，掌握了在49mm×96mm的面积上可一模射出两百件微型模内注塑技术，达到国际先进水平。对滑轨产品的塑胶零件和部分连接器产品采用热流道射出技术，与传统射出技术相比，塑胶水口料减少了70%以上，较大的降低了材料消耗。

5、自动化组装设备开发应用技术

目前国内多数连接器厂商采用手工或半自动化组装，公司为了保证产品精度提高生产效率，专门成立了自动化装备部门，专业开发用于微小型精密连接器、精密

型电磁屏蔽件、手机滑轨、表面贴装式 LED 精密支架生产所需的自动化生产装备，量产连接器产品 80%以上实现自动化生产，表面贴装式 LED 精密支架在国内率先实现自动化生产，复合式屏蔽件激光焊接等重要工序也实现了流水化生产。

（3）发行人正在研究开发的项目

公司紧扣移动通信终端、数码产品和光电产品领域精密电子零组件发展趋势，研究客户的应用需求，围绕着产品微型化、薄型化、高精度、低功耗、多功能、复合化、组件化、模块化、智能化等，不断地进行创新开发，力求使产品技术水平始终保持在行业前沿水平。

正在进行的项目：

序号	项目名称	研制程度	技术目标
1	精度为单向公差 1 μ m 模具加工技术	已立项完成团队组建	2012 年完成研发
2	用于通信设备高密度屏蔽条	已进入样品试验阶段	2010 年完成研发
3	手机多层滑轨	已进入产品设计阶段	2010 年完成研发
4	手机模内扣合式屏蔽件	已进入小批量阶段	2010 年完成研发
5	手机和数码产品 USB3.0 连接器	已进入产品设计阶段	2010 年完成研发
6	多功能记忆卡类连接器	已进入小批量阶段	2010 年完成研发
7	背光显示和照明两用贴装式 LED 支架	已进入小批量阶段	2010 年完成研发
8	大功率热电分离贴装式 LED 支架	已进入产品设计阶段	2011 年完成研发
9	手机和数码产品 BTB/FPC 连接器	已进入小批量阶段	2010 年完成研发

（二）发行人持续创新的相关制度及保障措施

技术创新是公司一项长期的发展战略，并实施了一系列措施保障持续创新的有序进行：

1、持股安排

为增强公司凝聚力，提高公司竞争力，2007 年 11 月，公司实施了持股安排计划，公司主要高级管理人员、核心技术人员、关键管理人员和技术骨干持有本公司股份，通过股权激励安排，上述人员的个人利益与公司利益得到统一，能够激发其技术创新的热情，不断提高公司整体的技术创新能力，实现公司的可持续发展。公司拟上市后按照有关上市公司股权激励规定进一步推进股权激励计划，力争将股权激励范围覆盖大部分设计师和技师。

2、对研发人员实行绩效奖励

为充分调动研发人员的积极性，发挥专业人才的聪明才智，提升市场竞争力，研发中心制订了《精密五金产品研发人员绩效奖励办法》、《精密连接器产品研发人员绩效奖励办法》、《贴装式LED精密支架研发人员绩效奖励办法》等奖励办法，和研发相关配合部门也制订了系列化奖励措施。增强研发人员开发创新产品的活力，调动了人员的积极性，提高研发效率。

3、高效运行的组织结构

公司研发部门十分重视新技术、新产品的跟踪、开发，建立了以总经理为统一领导，技术中心主任负责，各部门领导具体负责；在产品开发设计过程中，实时保持沟通、联系，根据市场反馈的最新需求信息，产品、技术发展方向，组织方案论证、立项及实施，建立了以技术中心为核心，市场总部、品质部、生产运营部多部门紧密合作的高效研发模式。

4、以客户为导向进行研究开发

公司坚持以客户为导向，不断研究客户产品的应用趋势、需求状况，着重进行引导式市场开发，推进新产品、新工艺在下游客户的应用。以领先的技术，合理成本不断设计开发新产品，已形成了“储备一代、开发一代、量产一代、规划一代”的良性循环，以“高、新、快”抢占市场先机。

5、持续增长的创新投入

公司从资源上对持续创新与技术开发进行不断投入，坚持每年将销售收入的8%投入研发，公司不断寻找与招聘行业内优秀的技术人才、并且每年制度性的从高校招聘优秀的毕业生，悉心培训，以建立人才梯队。

公司加大对现有员工的培训投入，未来三年公司拟聘请国际知名加工技师对员工进行培训；派遣公司员工到国外进行培训学习，不断提高发行人员素质和专业技能。在国际领先的精密模具企业的加工工艺流程基础上制定发行人模具加工工艺流程，选择和运用世界上先进的模具材料，通过高端设备的配置人员素质的提升、工艺流程的改进和优质材料选用，使公司的模具加工精度不断提高。

6、良好的创新文化

公司研发及各个部门已经形成良好的创新文化，倡导员工开展合理化建议、鼓励员工开展各项革新活动，并给予奖励，员工的创新个性、行为特性受到很好的尊重和保护，诚信、勤勉、创新、合作已经成为公司的企业文化。

7、本次募投项目对于发行人保持持续创新能力的重要意义

根据本次发行上市的需要，结合发行人未来发展规划，经过充分的市场调研和论证。发行人拟定了“生产表面贴装式 LED 精密封装支架项目、生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目和生产手机及数码产品滑轨项目”三个募集资金投资项目。

此次募投资金投资项目引进的国外先进的设备，包括精密模具加工类设备、精密冲压类设备、模内成型自动化生产线、无尘生产装置、激光焊接设备、精密弹簧模组加工设备、注塑设备、组装类设备、产品及原料实验和检测类设备等，目的在于提高公司产品设计开发、模具设计开发以及制造加工等实力，提高生产效率，降低人工使用率进而降低生产成本，同时增强产品精度和质量稳定性。高端精密电子零部件的研发只有依靠先进的设备才能实现产业化、规模化生产，同时，更有利于公司的产品创新和工艺创新。

五、影响发行人未来成长的风险

发行人所处的行业为资金和技术密集型产业，影响发行人未来成长的主要风险来自技术风险和规模快速扩张带来的管理风险，发行人已积极采取一系列的应对措施，降低对其未来成长的影响。

（一）不能持续快速响应市场需求的风险

公司产品以定制化生产为主，客户需求的个性化较为明显。公司依托强大的研发、设计、制造能力，在深刻理解客户需求的基础上快速设计解决方案，及时匹配采购相关原材料，高效组织生产，形成快速响应，为客户产品迅速推向市场提供有力的支持。

报告期内，公司每年新产品开发数量保持 50%以上增长，模具开发数量由 2007 年的 550 副/年增加到 2009 年的 1,830 副/年。目前，公司能根据客户需求在 2 天内完成模具设计，8 天内完成模具制作，最快 10 天内投入量产。公司从模具设计到批量生产的整个生产周期通常为 20 天，远高于行业 30-40 天的平均水平，处于行业领先地位。

随着业务规模扩大、产品品种增加、应用领域拓广，面对众多客户日益多样化的需求，公司一方面扩充研发团队，增加产品研发和模具设计能力；一方面加大设备投入，扩大产能。但公司仍存在因快速设计能力和高效组织生产能力不足，而不能持续快速响应客户需求的风险。

（二）技术风险

发行人作为国家级高新技术企业，高度重视技术研发工作，以此推动公司的新技术开发和产业化，确保公司的营业收入及盈利水平的增长。公司一直致力于精密电子零组件的开发、生产和销售，根据市场需求开发了精密型电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式 LED 精密支架等一系列产品，产品技术水平和工艺质量均处于行业领先水平，为公司赢得了良好的市场声誉。2007 年、2008 年和 2009 年公司研发费用占主营业务收入的比重分别为 4.08%、8.88%和 8.80%。但由于技术及产品的快速更新换代可能对公司应用现有技术的产品生产构成冲击，如公司不能紧跟最新科技的发展，及时利用新技术，开发新产品，现有的产品和技术存在被淘汰的风险；或由于研发过程中的不确定因素而导致的技术开发失败或新技术无法产业化，将延缓公司营业收入及盈利能力的增长步伐，给公司经营带来风险。

（三）发行人规模扩大引致的管理风险

公司自成立以来持续快速发展，2007 年、2008 年和 2009 年营业收入分别为 18,151.47 万元、24,361.01 万元和 27,603.19 万元；归属于母公司所有者的净利润分别为 3,805.79 万元、4,575.02 万元和 5,423.23 万元；员工人数也从 2007 年初的 662 人迅速扩充到 2009 年 12 月底的 2,022 人。本次发行后，随着募集资金投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员将进一步扩张。

尽管公司管理层在多年的经营过程中积累了丰富的管理经验，建立了规范的法人治理体系、质量控制及项目管理体系，经营模式和营销体系也较为成熟，但仍然

存在现有管理体系不能适应未来公司快速扩张的风险。如果公司管理体系不能适应发展的需要，公司的经营业绩将受到一定程度的影响。

七、本保荐机构关于发行人成长性专项意见

（一）尽职调查及审慎核查过程

本保荐机构对发行人的成长性进行了尽职调查，通过审慎核查公司治理、内部控制等制度建设，确保公司制度建设已逐步得到有效执行；审慎核查发行人的创新制度、创新投入、创新成果等，确保发行人具有独立的可持续的自主创新能力；审慎核查发行人采购、生产、销售、研发及管理各环节的工作，确保发行人经营工作的有序运作；走访主要顾客和供应商，确保发行人的营销及采购渠道的正常有效；收集行业资料、走访行业专家，与专业的行业研究机构共同分析发行人所处行业的现状及发展趋势；与律师、会计师保持密切沟通，确保发行人在法律、财务方面的合法合规性。同时，根据发行人目前的业绩和发展现状，结合可能存在的风险因素，本保荐机构对发行人主营业务、行业发展前景、自主创新能力、主要产品的优劣势、前沿技术更替、募集资金运用计划以及未来发展与规划等影响公司持续成长的各方面进行了尽职调查、审慎核查和独立分析判断。

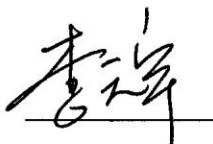
（二）结论

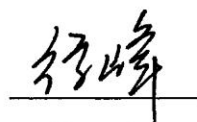
经本保荐机构查证确认，认为发行人在报告期内体现了良好的成长性，成长情况真实有效、符合相关法律法规、不存在虚假、误导或者重大风险。

发行人所处的外部环境和内在的成长性均有利于发行人未来的持续成长：发行人所处行业是有市场应用前景广阔，需求快速发展的行业；具备较强的自主创新能力；拥有领先的技术优势和管理优势以及快速的市场反映能力；主要产品拥有明显的竞争优势。同时，公司为确保未来持续成长，制定了有效的未来发展与规划，充分分析影响未来成长的风险并制定了应对措施。若发行人未来发展与规划及风险应对措施能够顺利实施，将为发行人未来的持续成长提供良好的条件，发行人将具有良好的持续成长性。

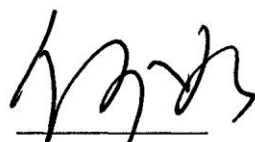
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司成长性的专项意见》之签字盖章页】

保荐代表人：


李天宇


徐 峰

法定代表人：


何 如

